

Hisense[®]

多媒体产品维修手册

LED55EC780UC

主板方案：MSD6A828
电源方案：HLL-4960WA

多媒体研发中心

2016.9



目 录

LED55EC780UC	3
一、产品介绍	3
(一)、产品外观介绍	3
外观图:	3
端子图:	4
(二)、产品功能规格、特点介绍	5
技术参数:	5
视频支持格式:	6
HDMI、分量输入端口支持的信号格式:	6
(三)、产品差异介绍	6
主板差异:	7
电源板差异:	7
二、产品方案概述	7
整机内部图	7
整机信号流程图	8
电源分配图	10
三、主板原理说明	11
主板实物图	11
主板电路原理图	13
四、电源板原理说明	33
A、产品介绍:	33
B、方案概述	33
C、分部原理说明	34
(一)、反激电路	34
(二)、PFC 电路	36
(三)、LLC 电路	37
D、常见故障分析	39
E、单板检修流程	39
五、产品爆炸图及明细	41
六、软件升级方法	41
A、Mstar 机芯调试工具及安装方法介绍	41
B、升级方法介绍	42
C、Mboot 程序和 6m40 程序烧写注意事项	45
D、升级之后的相关维护工作	54
E、如何获取有效的 Log 信息	55
F、故障板的常规判断方法	55

液晶电视服务手册

LED55EC780UC

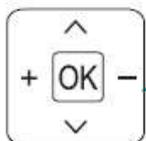
一、产品介绍

(一)、产品外观介绍

长按OK键屏幕可弹出如下图按键菜单



后面观看效果
控制面板在后壳上



注：本机不支持找回遥控器功能。

遥控接收窗

指示灯

蓝牙对码处 $\hat{=}$ (65")
(本机不提供蓝牙附件)

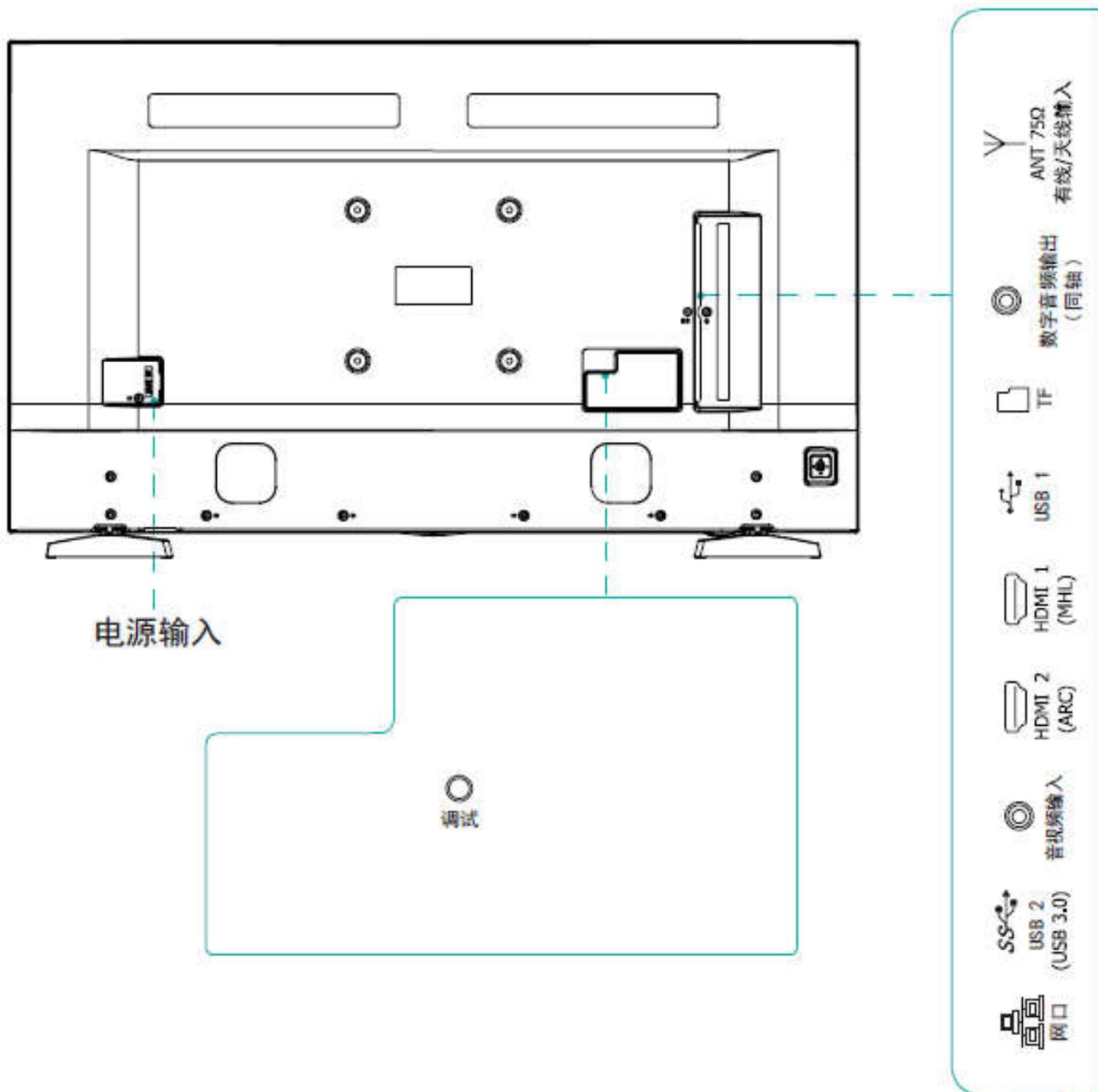
蓝牙对码处 $\hat{=}$ (55")
(本机不提供蓝牙附件)

外观图：

(因拍摄技术有限，图片仅供参考)



端子图:



(二)、产品功能规格、特点介绍
 技术参数:

型 号		LED55EC780UC	LED65EC780UC
产品名称		液晶电视	液晶电视
产品尺寸 (mm) (宽 × 高 × 厚)	不含底座	1237 × 722 × 113	1452 × 842 × 144
	含底座	1237 × 753 × 240	1452 × 878 × 289
产品质量 (kg)	不含底座	18.8	27.3
	含底座	19.2	28.1
可视图象对角线尺寸 (cm)		138	163
显示屏分辨率		3840 × 2160	3840 × 2160
整机消耗功率		150W	180W
伴音功率		10W+10W	15W+15W
执行标准		Q/0202RSR 609	
电源输入		~ 50Hz 220V	
接收制式	射频	PAL(D/K、I、B/G)、NTSC(M)、DTMB	
	视频	PAL、NTSC	
接收频道		广播电视频道 C01 ~ C57CATV 增补频道 Z01 ~ Z38	
环境条件		工作温度 5°C ~ 35°C 工作湿度 20% ~ 80%RH 大气压力 86kPa ~ 106kPa	
天线阻抗		75Ω	

视频支持格式:

封装	视频解码				音频解码
	类型	分辨率 (最大)	比特率 (最大)	帧率 (最大)	
.avi	Xvid	1920×1080	40Mbps	60fps	E-AC3, AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .ts	MPEG2	1920×1080	40Mbps	60fps	E-AC3, AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.ts .mkv .avi .mp4 .flv	H.264	1920×1080	100Mbps	60fps	E-AC3, AC3, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .mov	MPEG4	1920×1080	40Mbps	60fps	E-AC3, AC3, MPEG1(Layer1,2,3)
.mkv .mp4 .ts	H.264	4096×2160	125Mbps	30fps	E-AC3, AC3, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)
.rm .rmvb	RV30 RV40	1920×1080	40Mbps	60fps	Cooper
.ts .mkv .mp4	H.265	4096×2160	100Mbps	60fps	E-AC3, AC3, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)

HDMI、分量输入端口支持的信号格式:

HDMI 端口支持的信号格式	
RGB/60Hz	640×480、800×600、1024×768
YUV/50Hz	576i、576p、720p、1080i、1080p
YUV/60Hz	480i、480p、720p、1080i、1080p
YUV/24Hz 25Hz 30Hz	3840 x 2160
YUV/24Hz	4096×2160
YUV420/50Hz 60Hz	3840 x 2160

(三)、产品差异介绍

204912	液晶屏\HE550IUC-B52\S1
201845	主板组件\RSAG2.908.6935-04\ROH
198571	电源板组件\RSAG2.908.6570-03\ROH

主板差异:

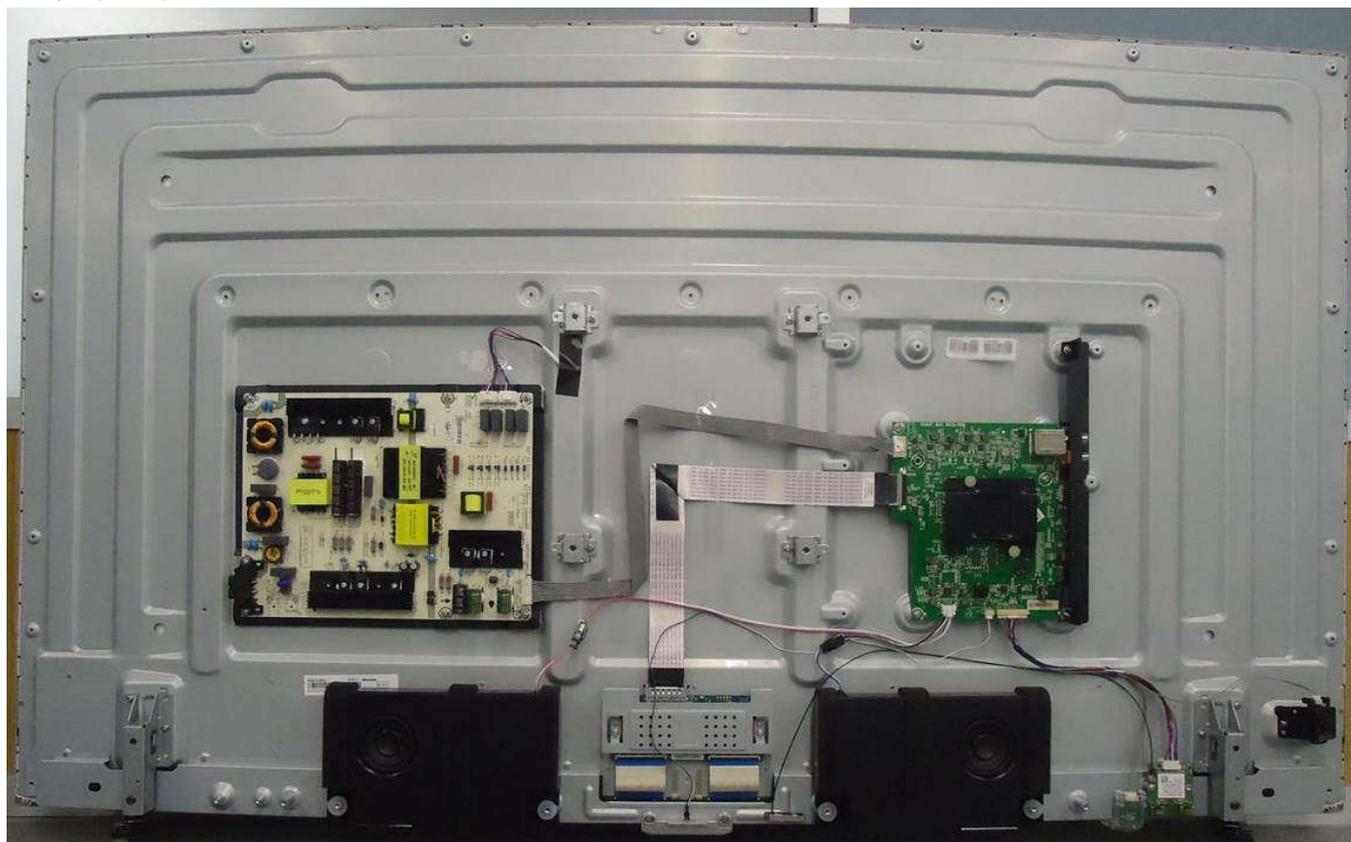
本机型主板组件为原型组件, 暂无通用。

电源板差异:

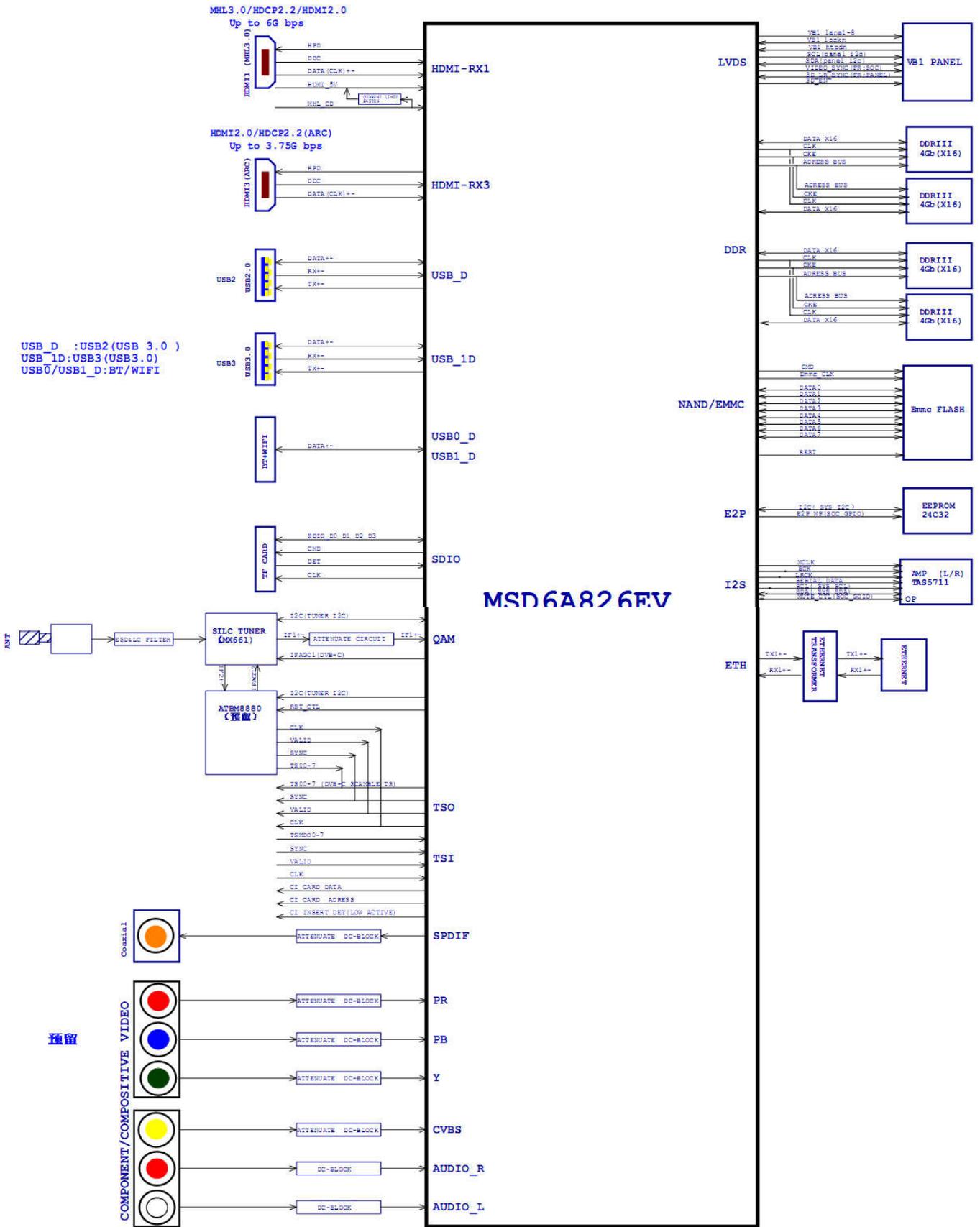
本机型电源板组件为原型组件, 暂无通用。

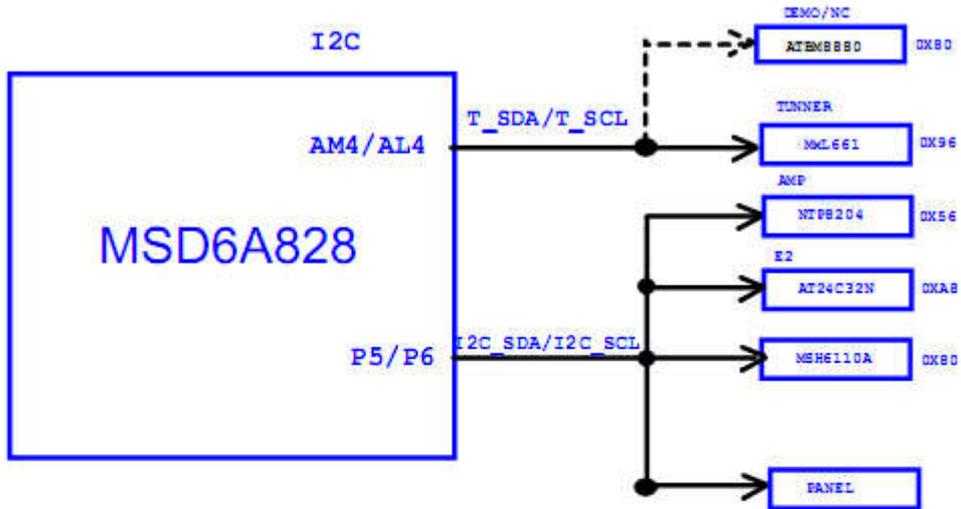
二、产品方案概述

整机内部图

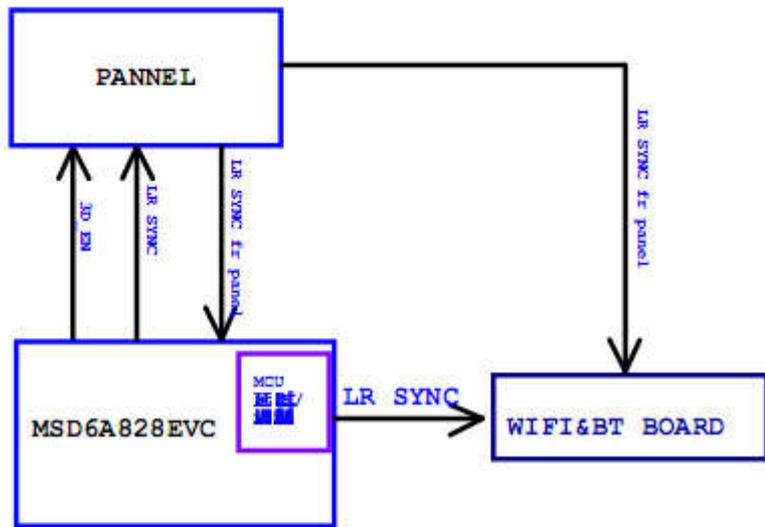


整机信号流程图

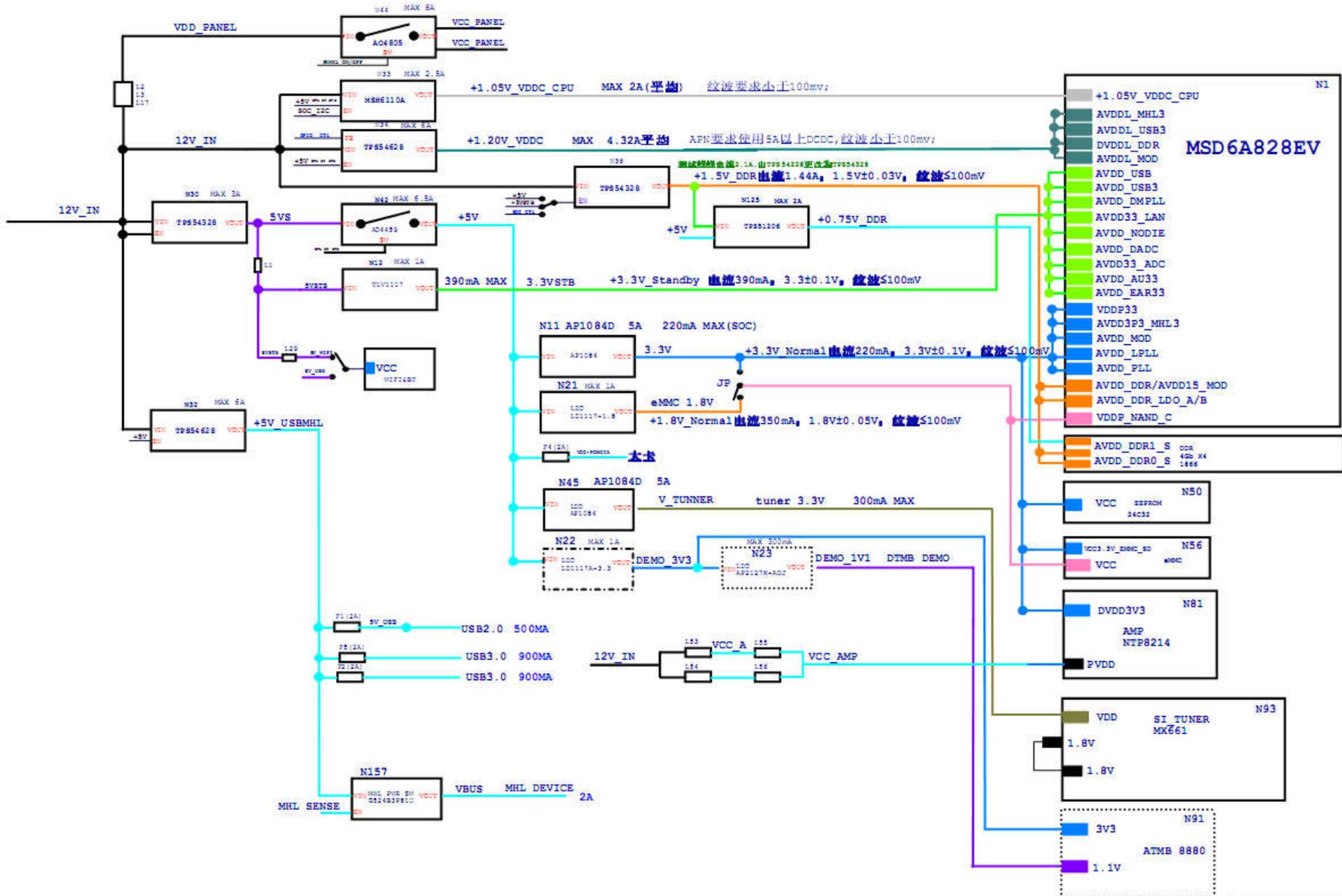




3D信号流程图1

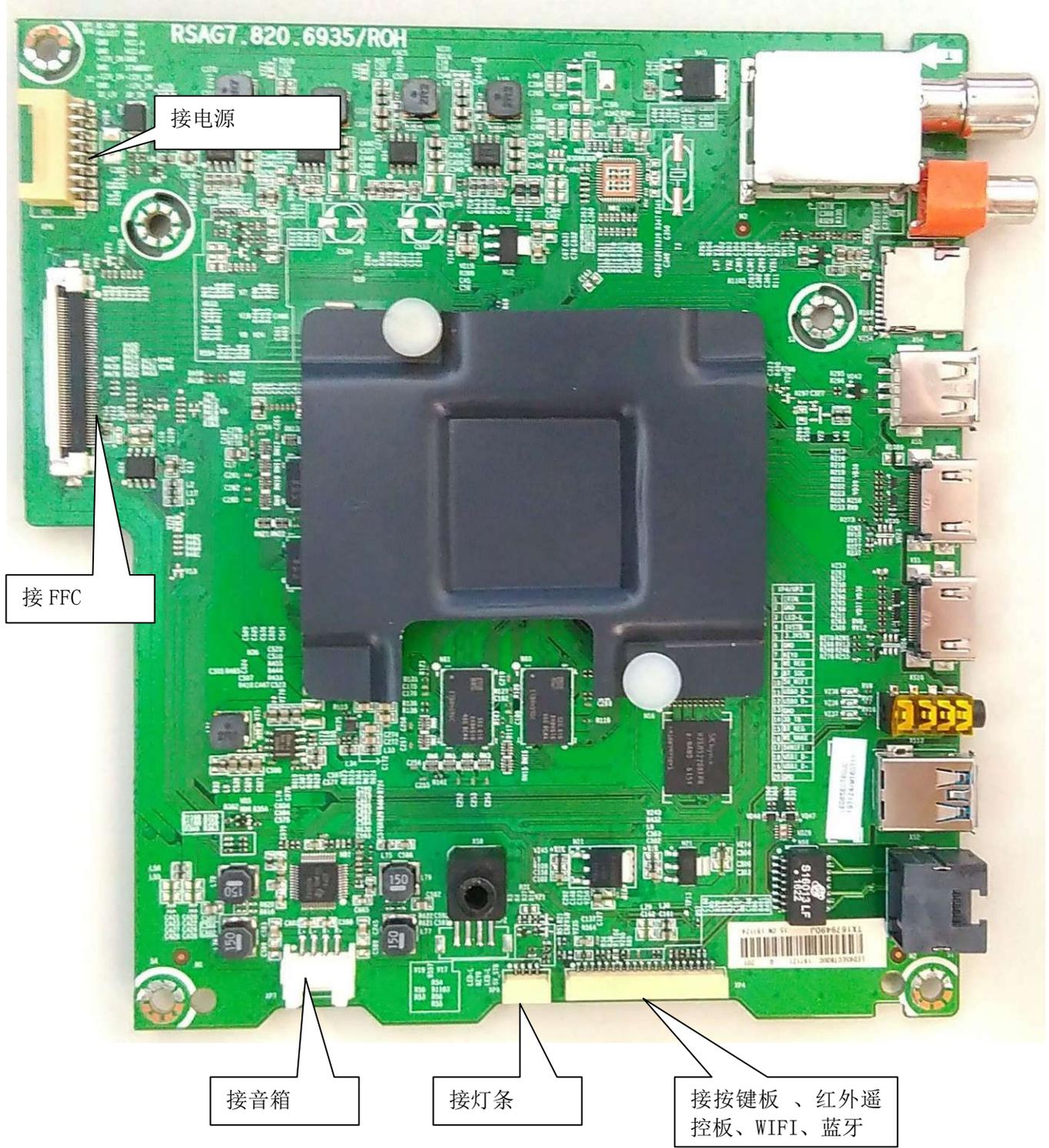


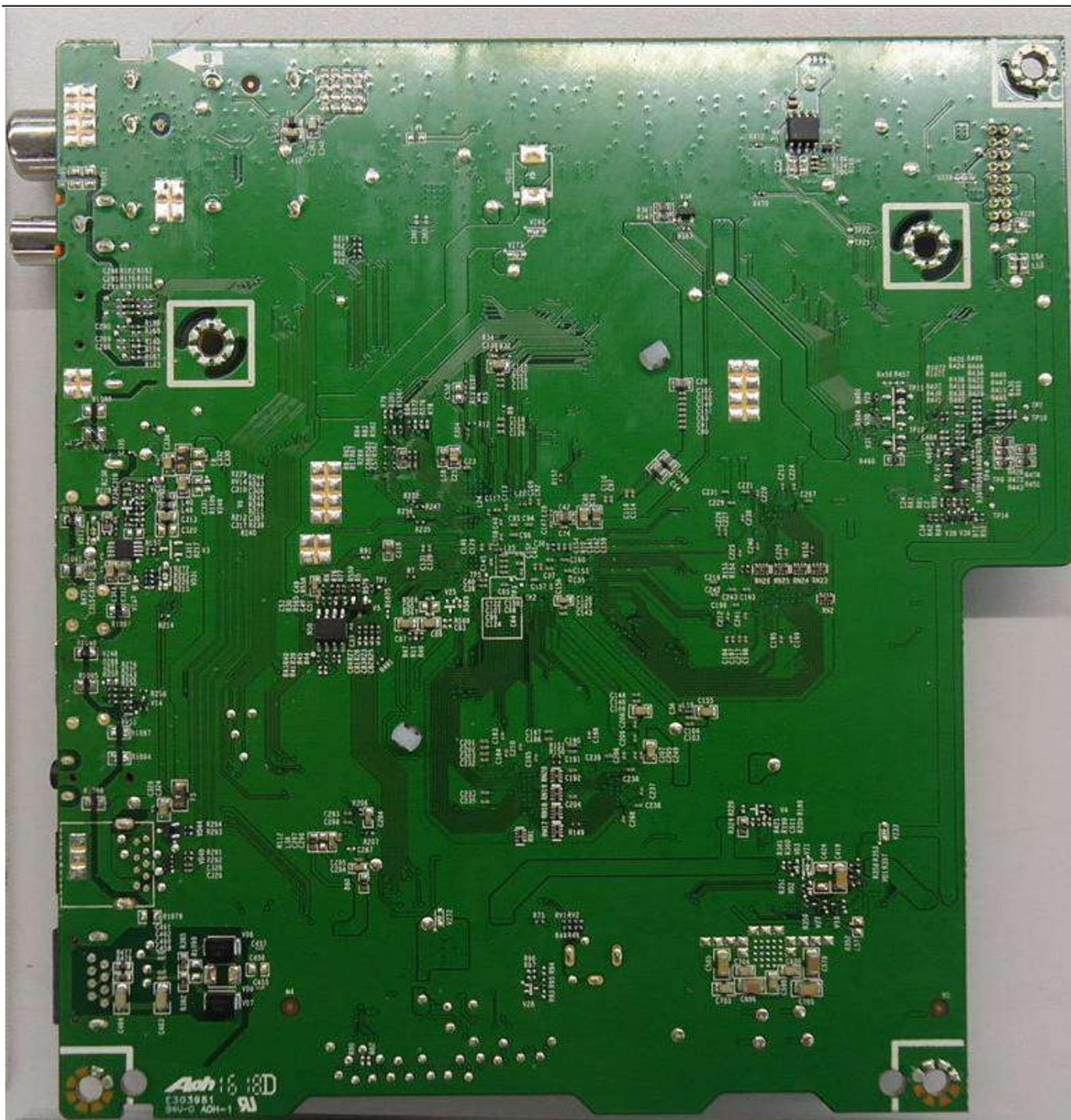
电源分配图

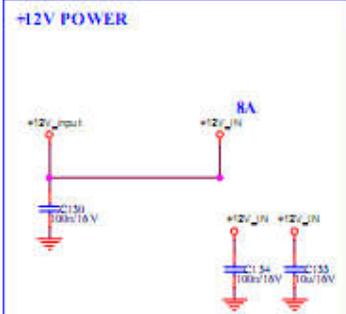
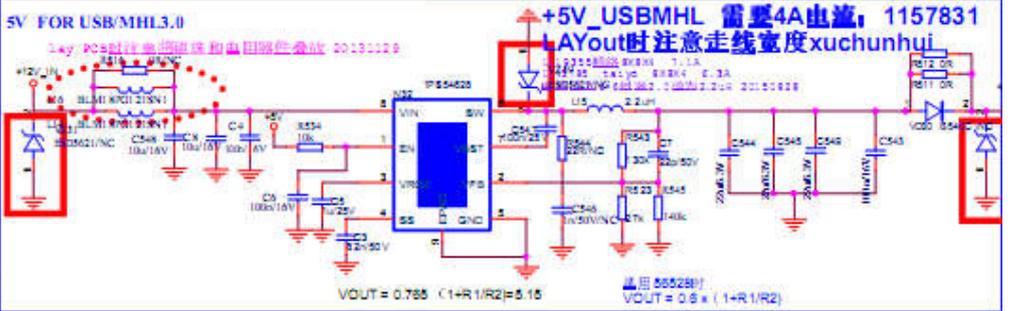
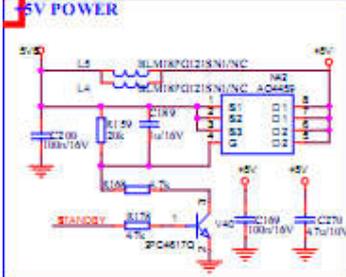
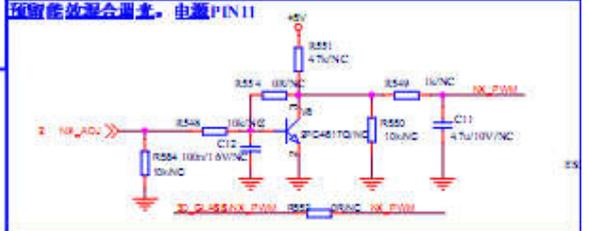
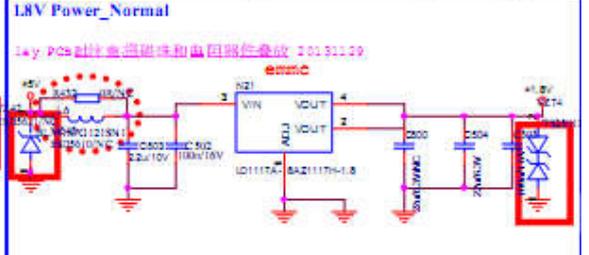
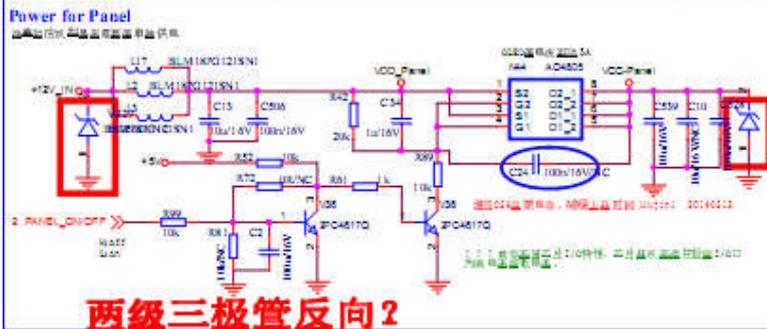
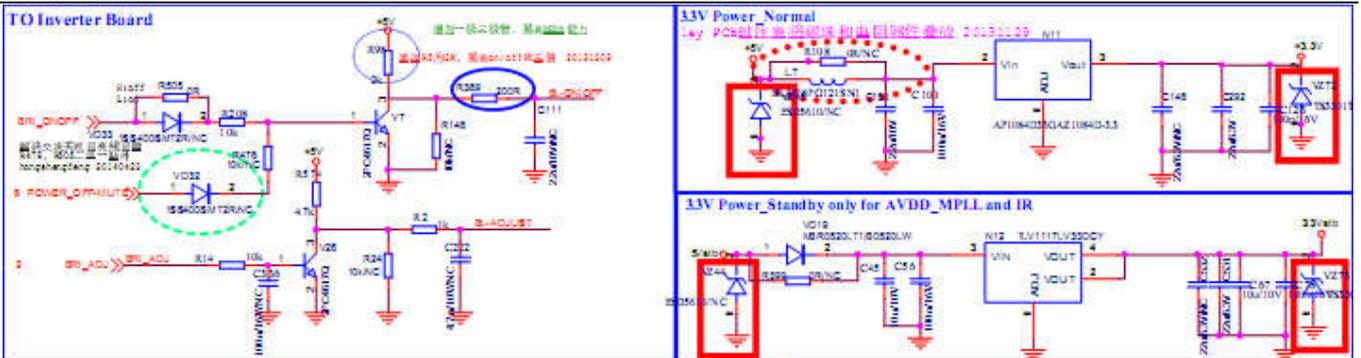


三、主板原理说明

主板实物图

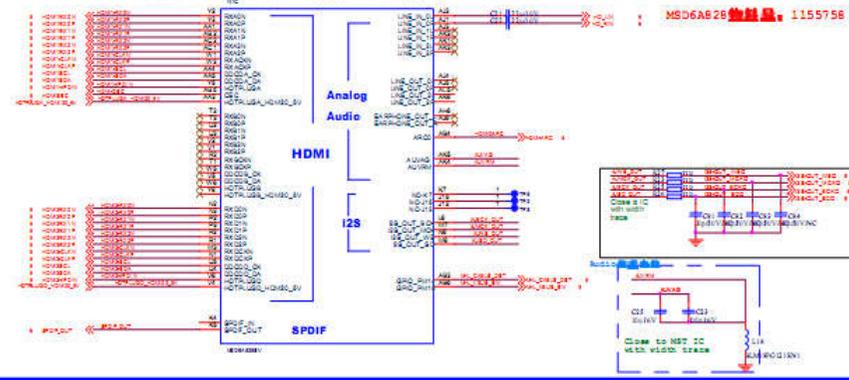




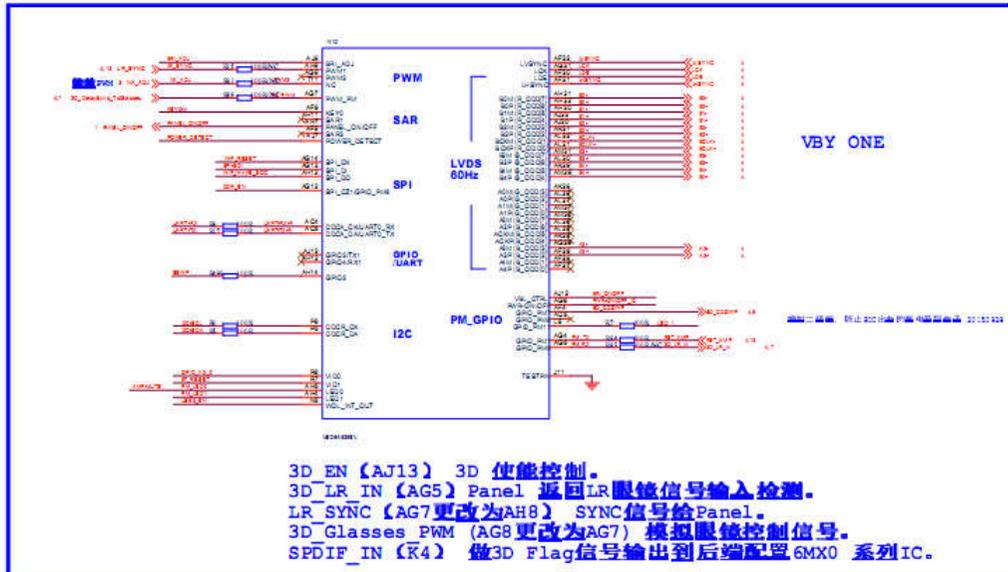
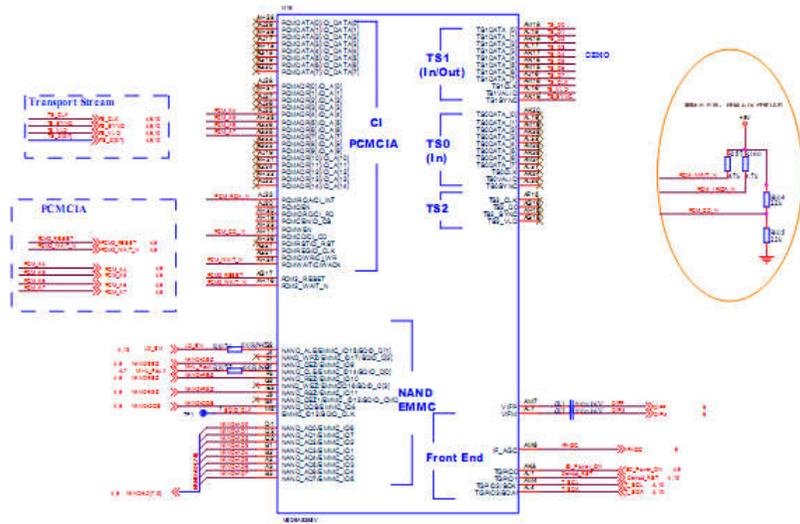
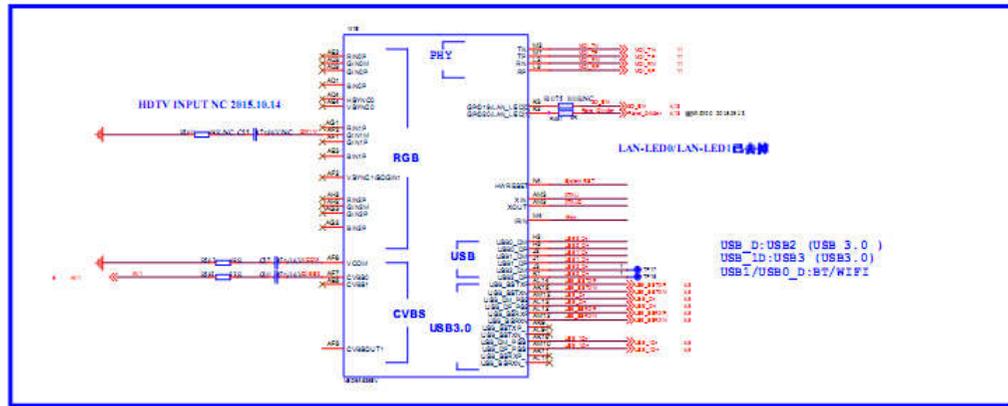


HDMI/Audio Block

Note : Port A needs shielding ground all signal pair



Video Block



3D_EN (AJ13) 3D 使能控制。
 3D_LR_IN (AG5) Panel 返回LR眼镜信号输入检测。
 LR_SYNC (AG7更改为AH8) SYNC信号给Panel。
 3D_Glasses_PWM (AG8更改为AG7) 模拟眼镜控制信号。
 SPDIF_IN (K4) 做3D Flag信号输出到后端配置6MX0 系列IC。

IC Configuration Selection

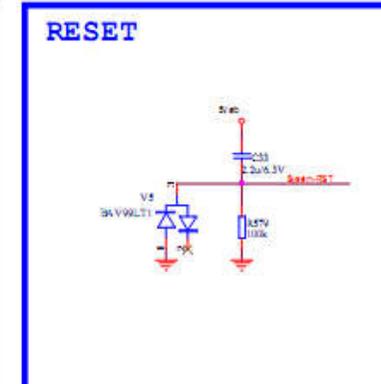
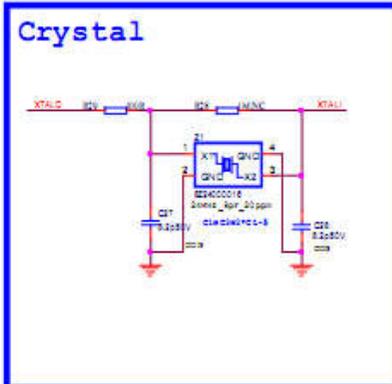
CHIP_CONFIG[3:0] [PAD_LED1, PAD_PM_SPI_DI, PAD_PM_LED0, PAD_PWM_PM]



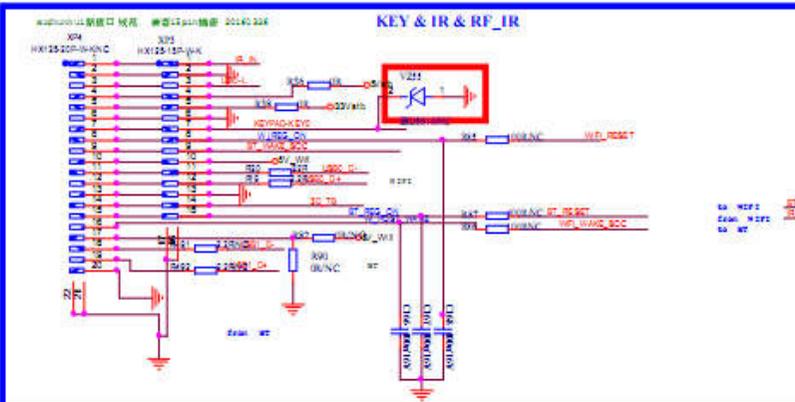
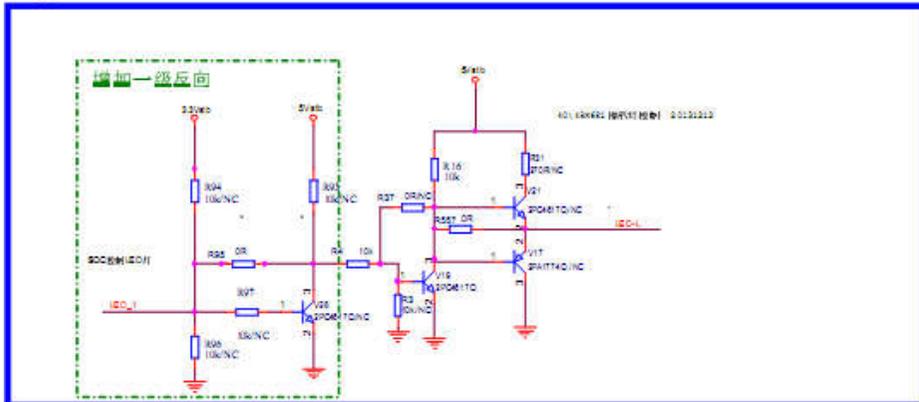
4'b1010

Value	Mode	Description
4'b1000	SB51_ExtSPI	S1 boot from SPI
4'b1001	HEMCU_ExtSPI	ARM boot from SPI
4'b1010	HEMCU_ROM_EMMC	ARM boot from ROM; outer storage is eMMC
4'b1011	HEMCU_ROM_NAND	ARM boot from ROM; outer storage is NAND
4'b1100	DBUS	for test only
4'b0000	SB51_ExtSPI + Authentication	S1 boot from SPI with ARM authentication
4'b0001	HEMCU_ExtSPI + Authentication	ARM boot from SPI with authentication
4'b0011	HEMCU_ROM_NAND + Authentication	ARM boot from ROM with authentication; outer storage is NAND

CHIP_CONFIG[3:0]
 (PAD_PM_LED1, PAD_PM_SPI_DI, PAD_PM_LED0, PAD_PWM_PM)

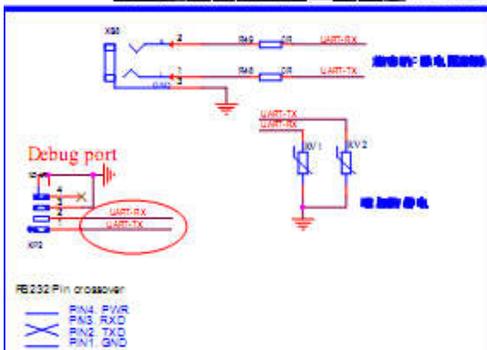


LED_CTRL

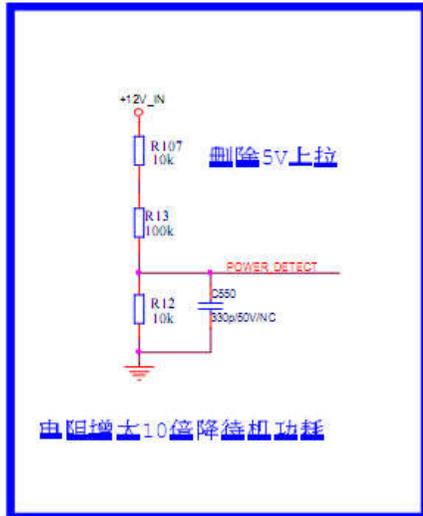


Urat

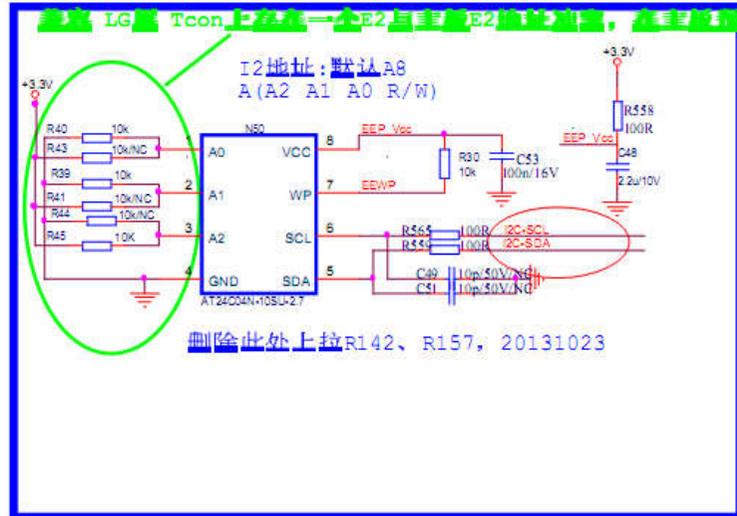
更改通孔回流采用立式端子 1141113



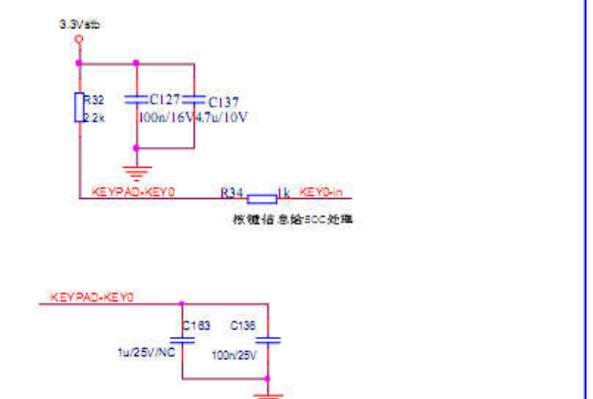
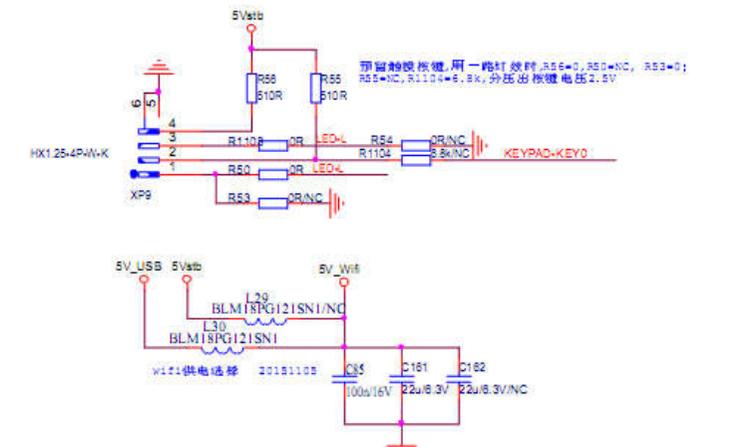
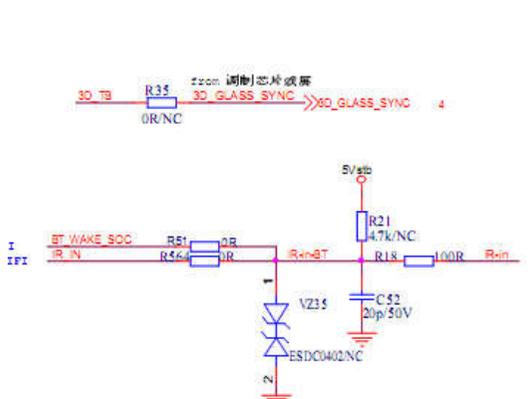
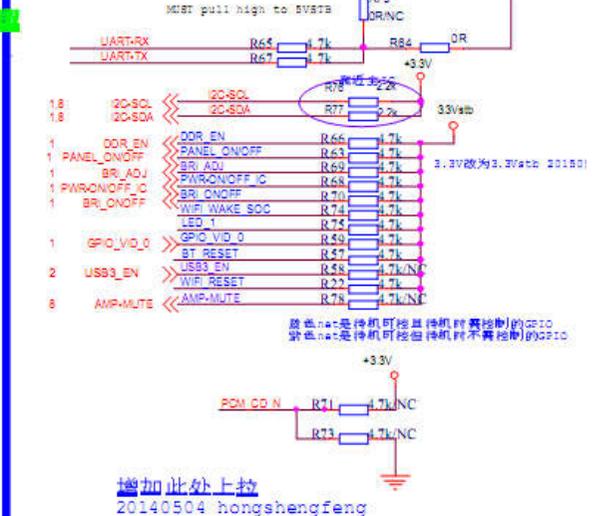
eMMC protect

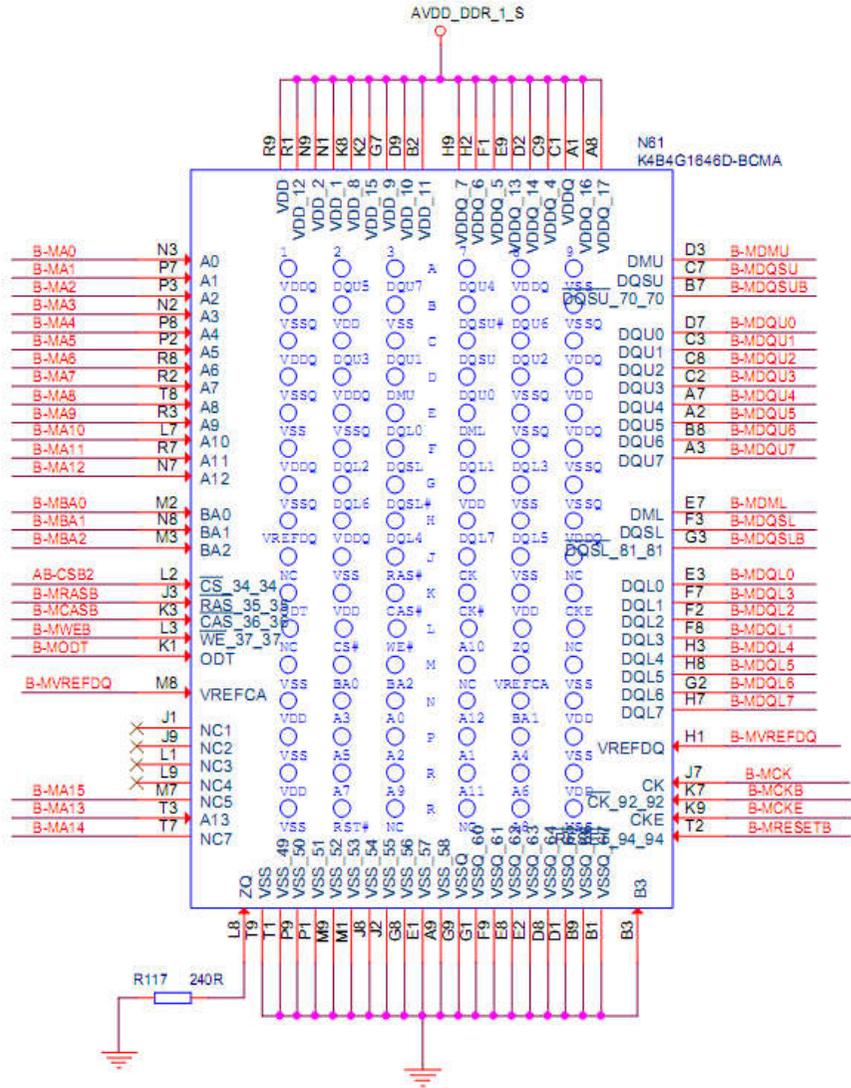
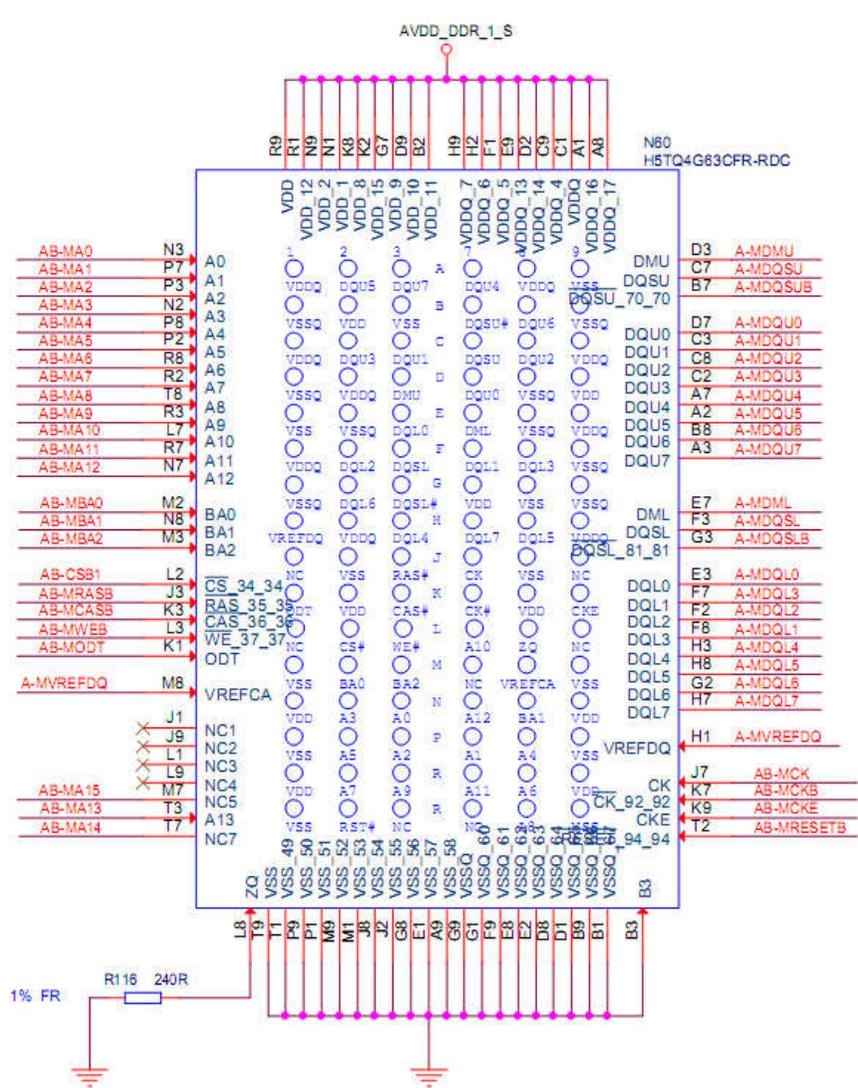


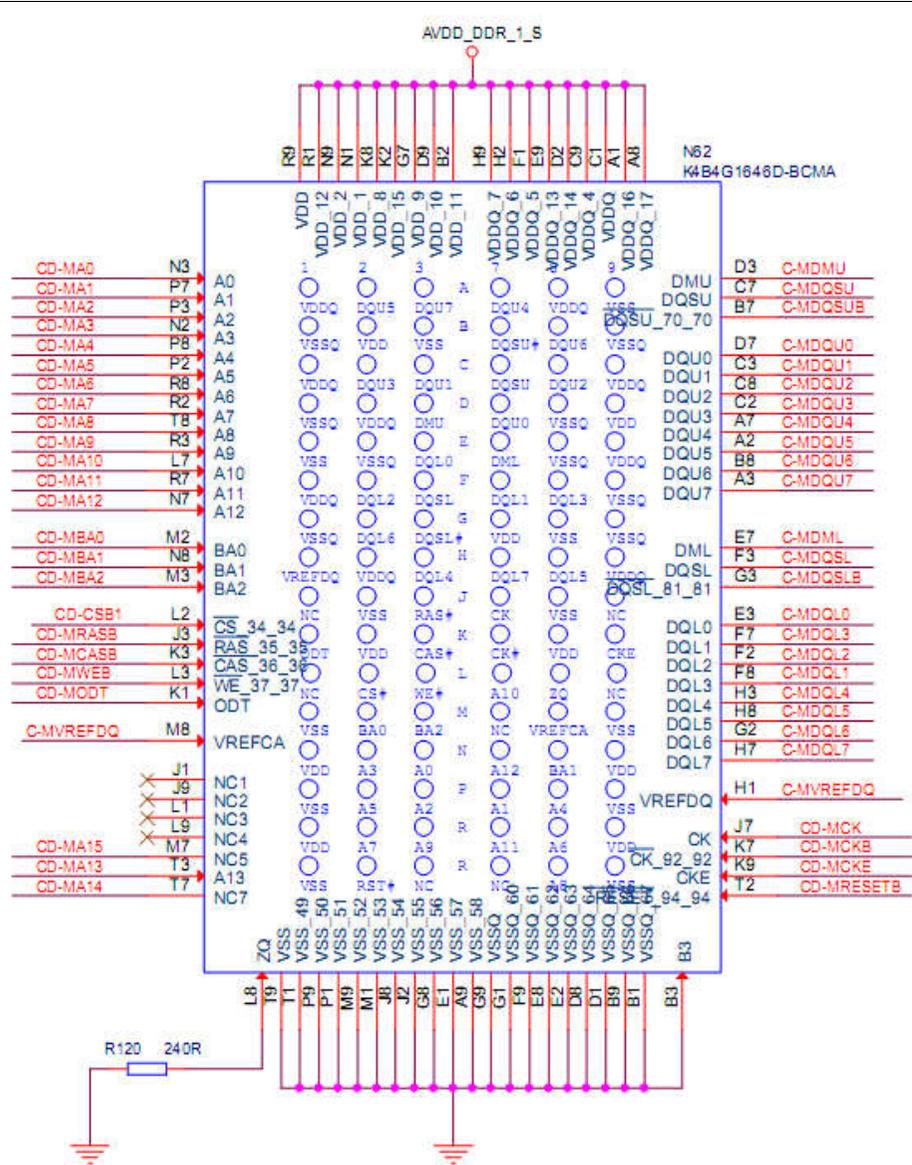
EEPROM



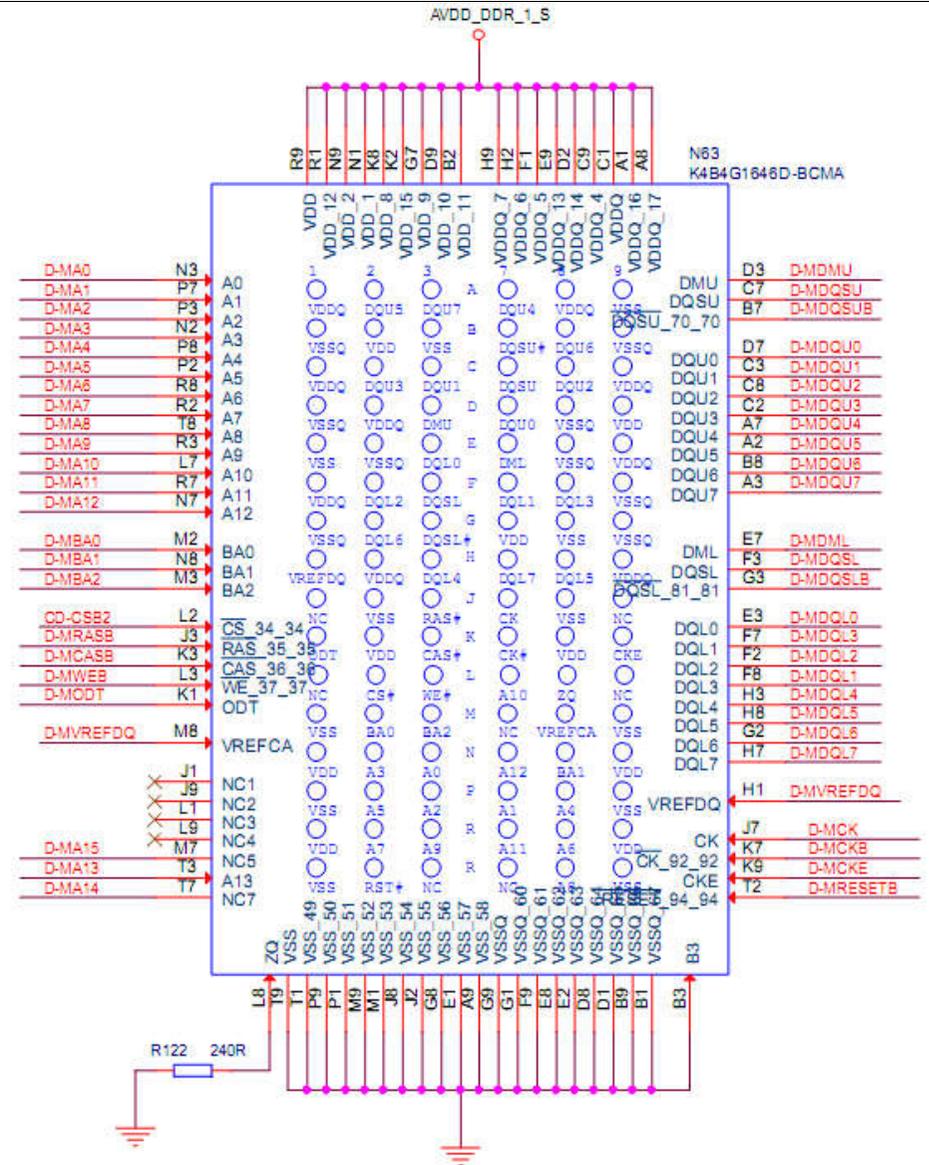
GPIO Pull Up/Down



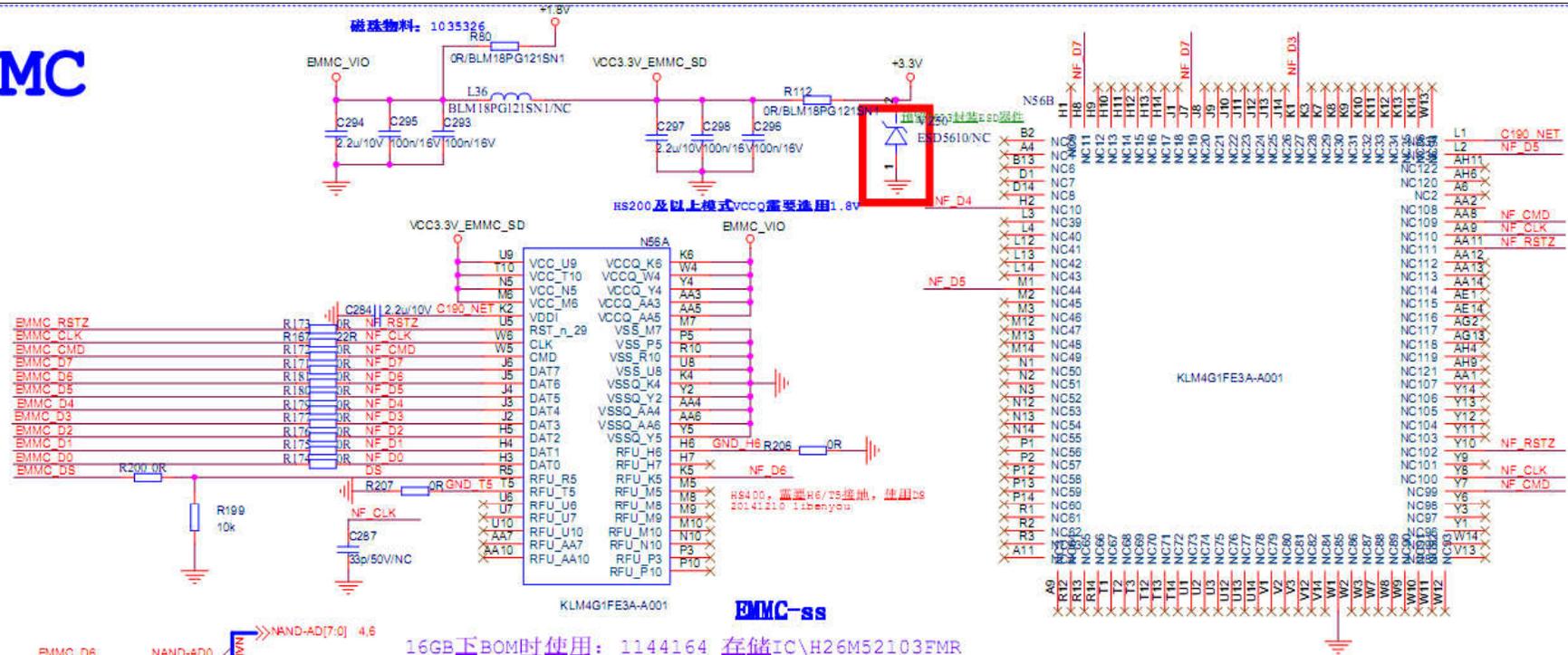




(Top side, close to DRAM)



eMMC

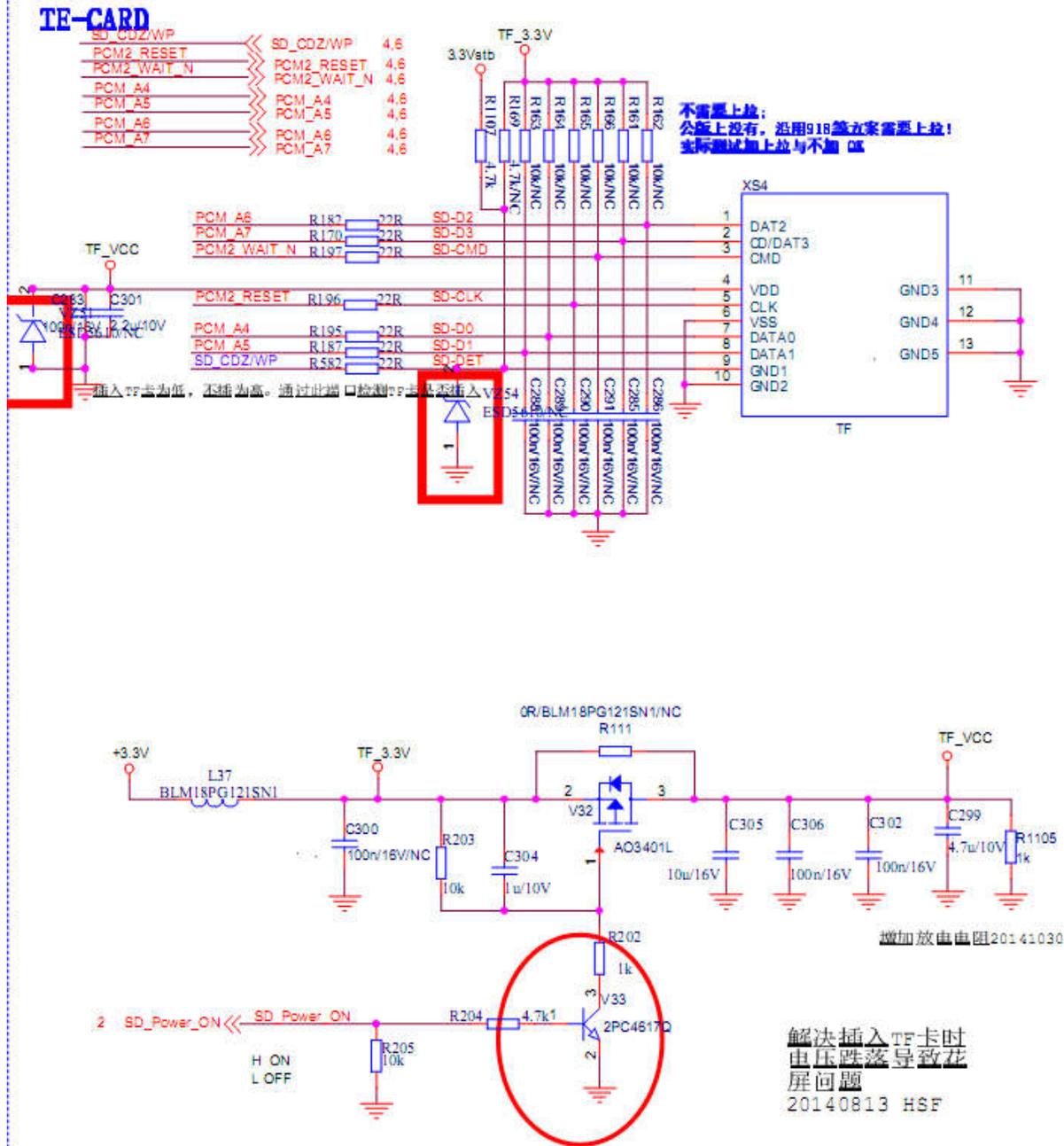


BMMC_D6	NAND-AD0	NAND-AD[7:0] 4.6
BMMC_D7	NAND-AD1	
BMMC_D2	NAND-AD2	
BMMC_D1	NAND-AD3	
BMMC_D0	NAND-AD4	
BMMC_D3	NAND-AD5	
BMMC_D4	NAND-AD6	
BMMC_D5	NAND-AD7	
BMMC_CMD	NAND-CEZ	NAND-CEZ 4.6
BMMC_CLK	NAND-REZ	NAND-REZ 4.6
BMMC_RSTZ	NAND-RBZ	NAND-RBZ 4.6
BMMC_DS	NAND-DQS	NAND-DQS 4.6

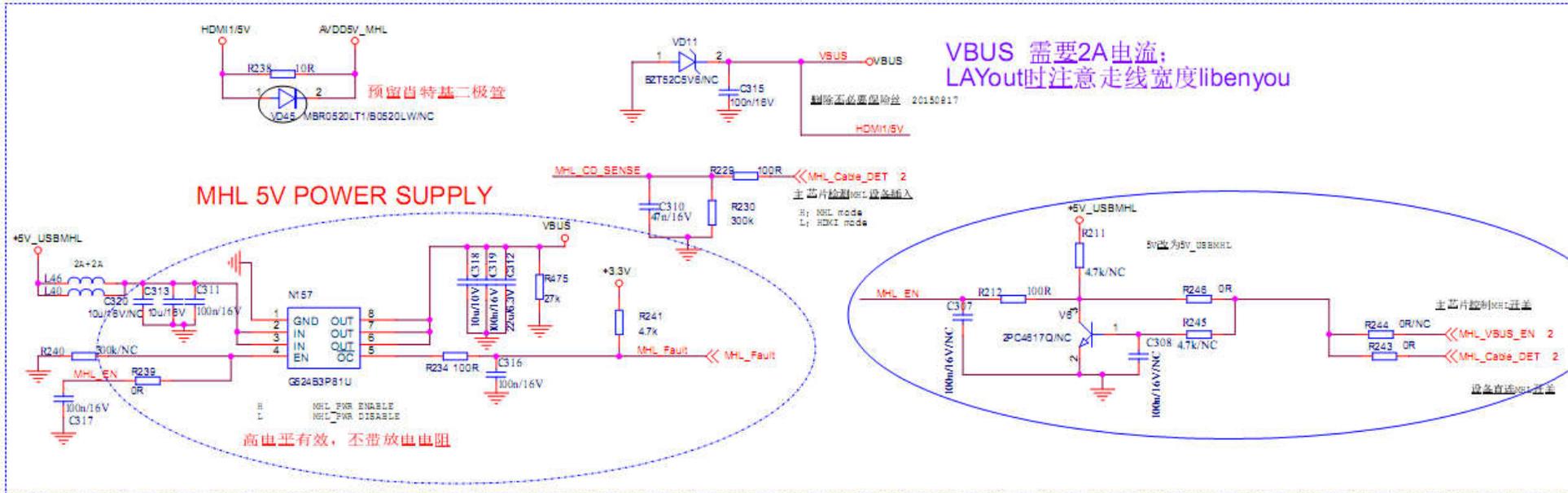
16GB下BOM时使用: 1144164 存储IC:H26M52103FMR

- 1,clk没有上拉 OK
- 2,R5 PIN HS400 DS
- 3,K5 PIN 700上接data6, 为了走线ok
- 4,AA2接地, 为走线ok;
- 5,HS400:H6/T5需要接地, 使用DS

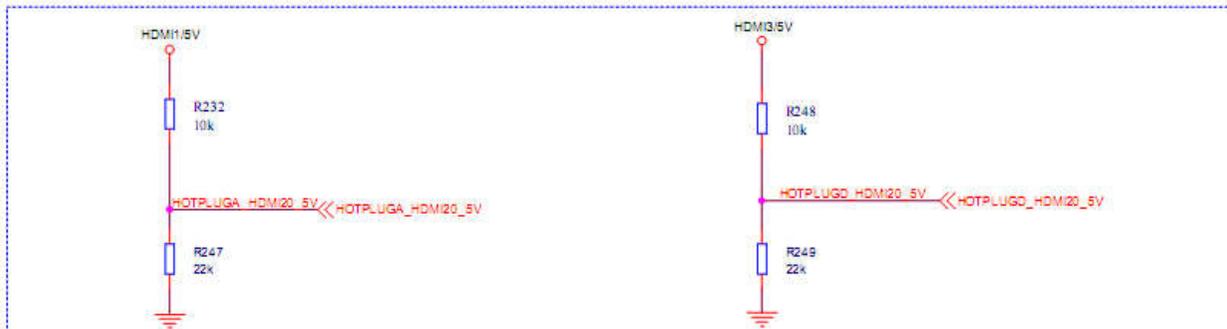
- 1,EMMC去掉AA2, 地线改走W1. AA2在东芝芯片中有定义;
- 2,EMMC有CLK和DS不能有过孔, 包地, 用到了以下几个NC脚.
NF_CMD:AA8\Y7
NF_CLK:AA9\Y8
NF_RSTZ:AA11\Y10



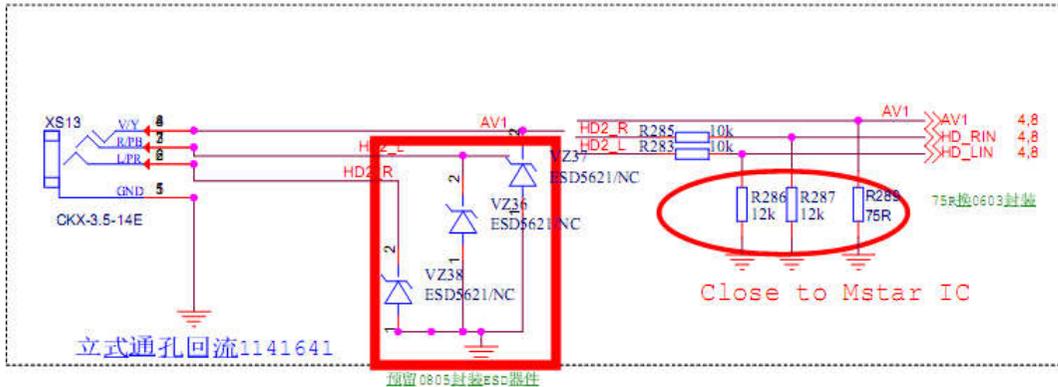
MHL Circuit



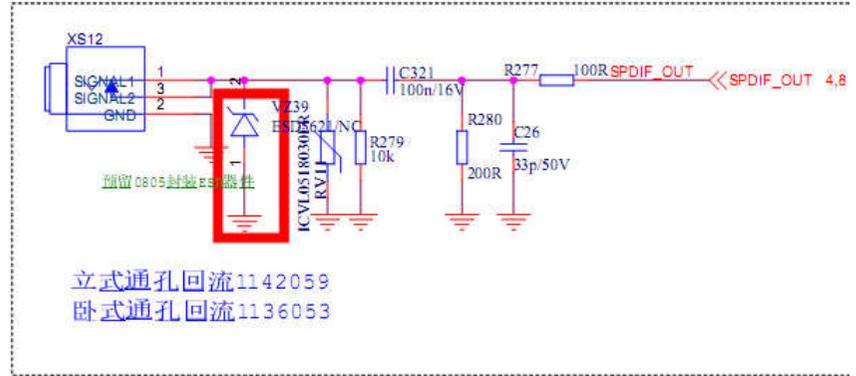
HDMI DETECT HDMI2.0认证检测增加此部分



AV Input (AV LR复用)



同轴

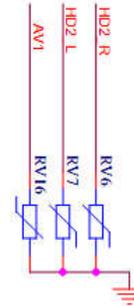


HDTV Input

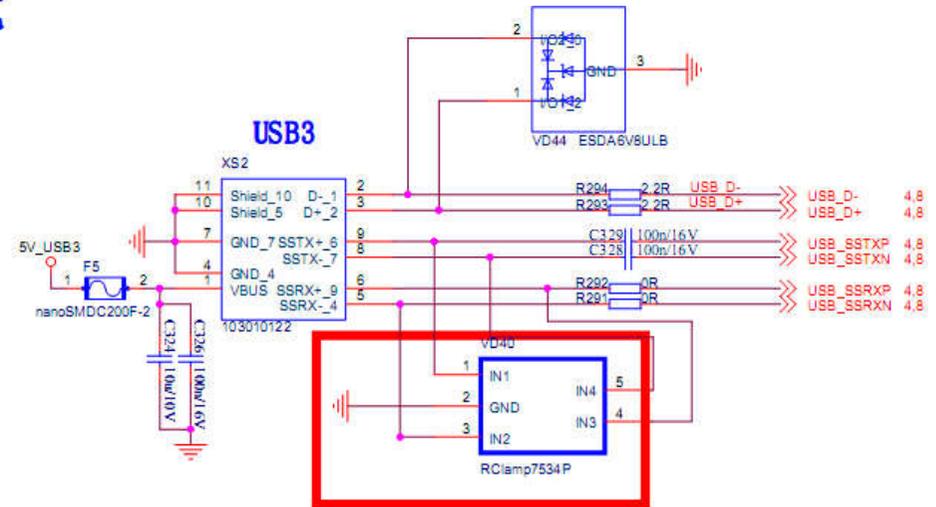
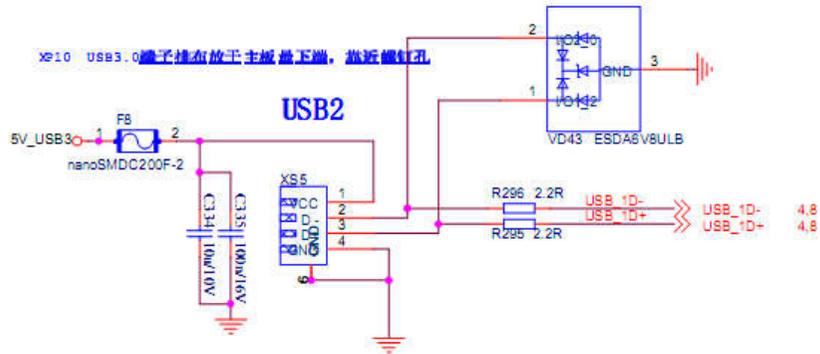
HDTV INPUT NC 2015.10.14

75R 0603 封装

ESD



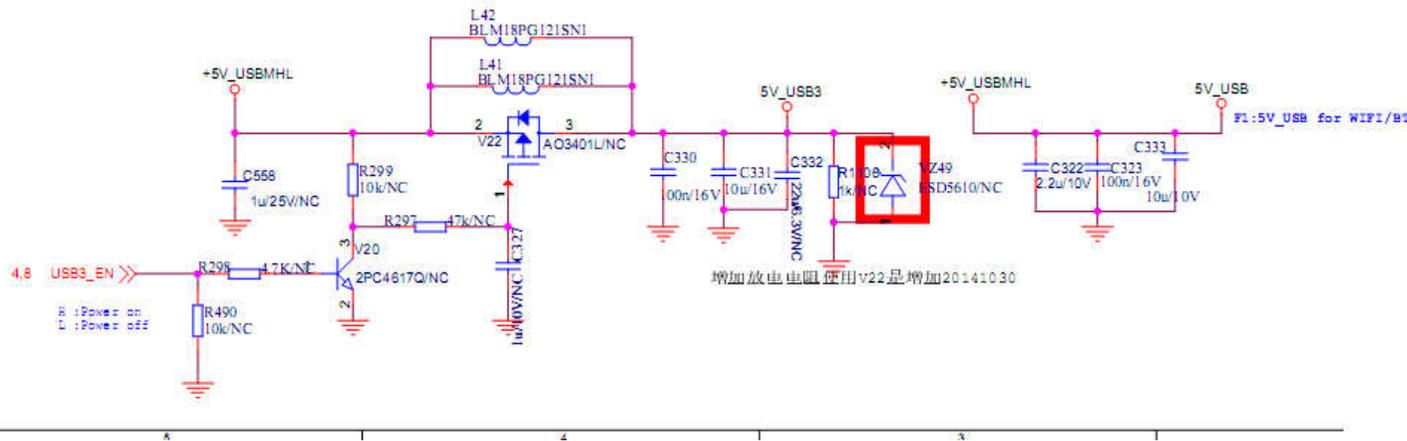
USB Interface USB 3.0需要厂家确保阻抗



USB POWER 5V~5.2V

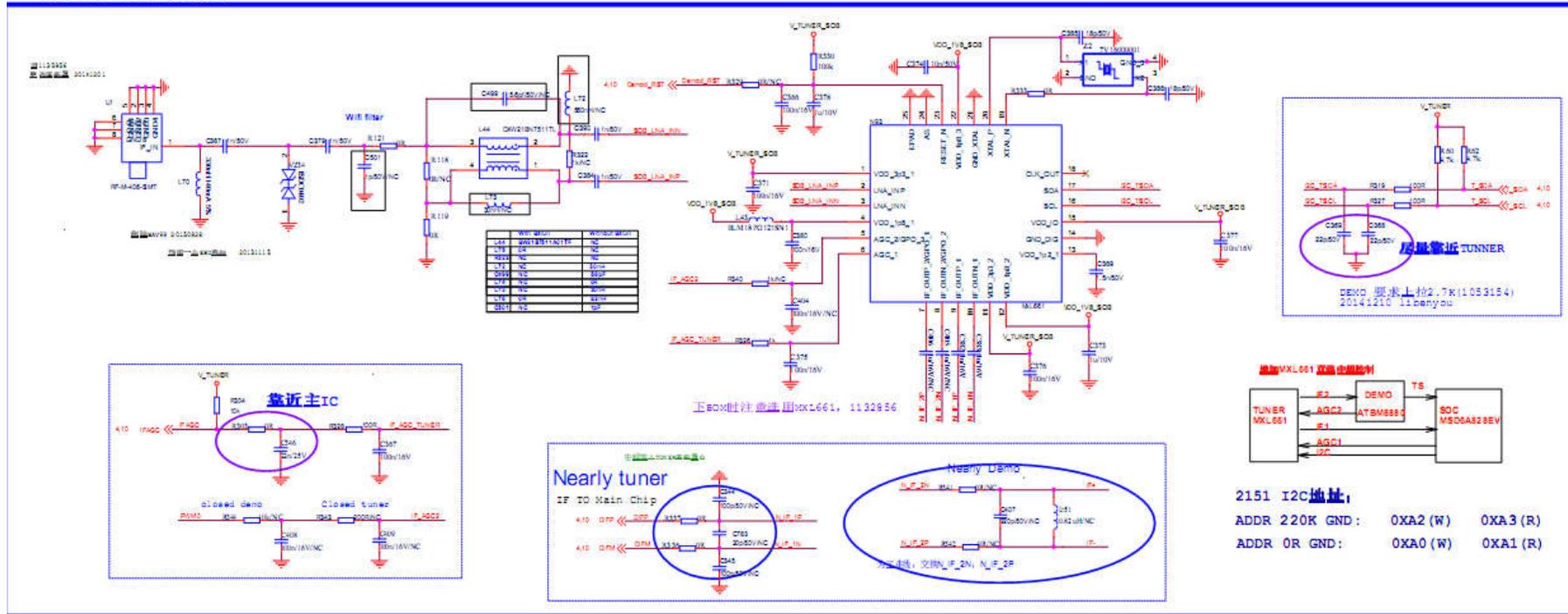
Note: 电容靠近USB端子, 提供usb读写稳定性

USB_D:USB2 (USB 3.0)
 USB_1D :USB3 (USB3.0)
 USB0/USB1_D:BT/WIFI
 USBM:- USBP:+



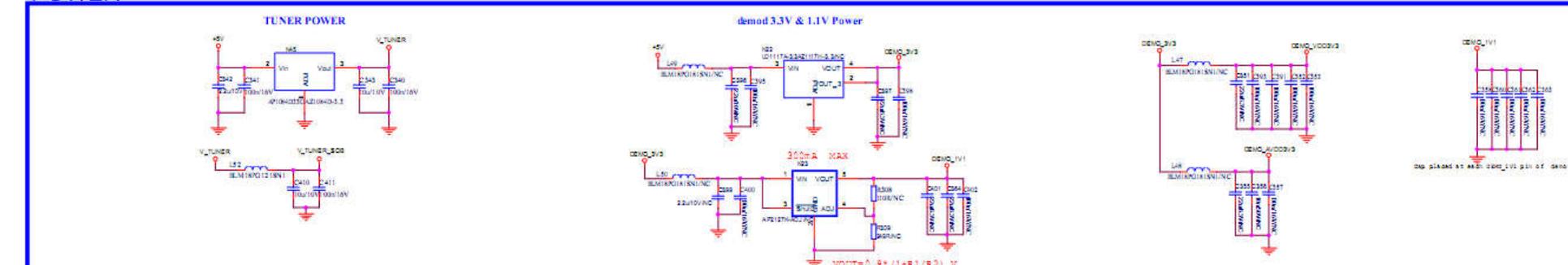
Silicon On Board

DEMOM

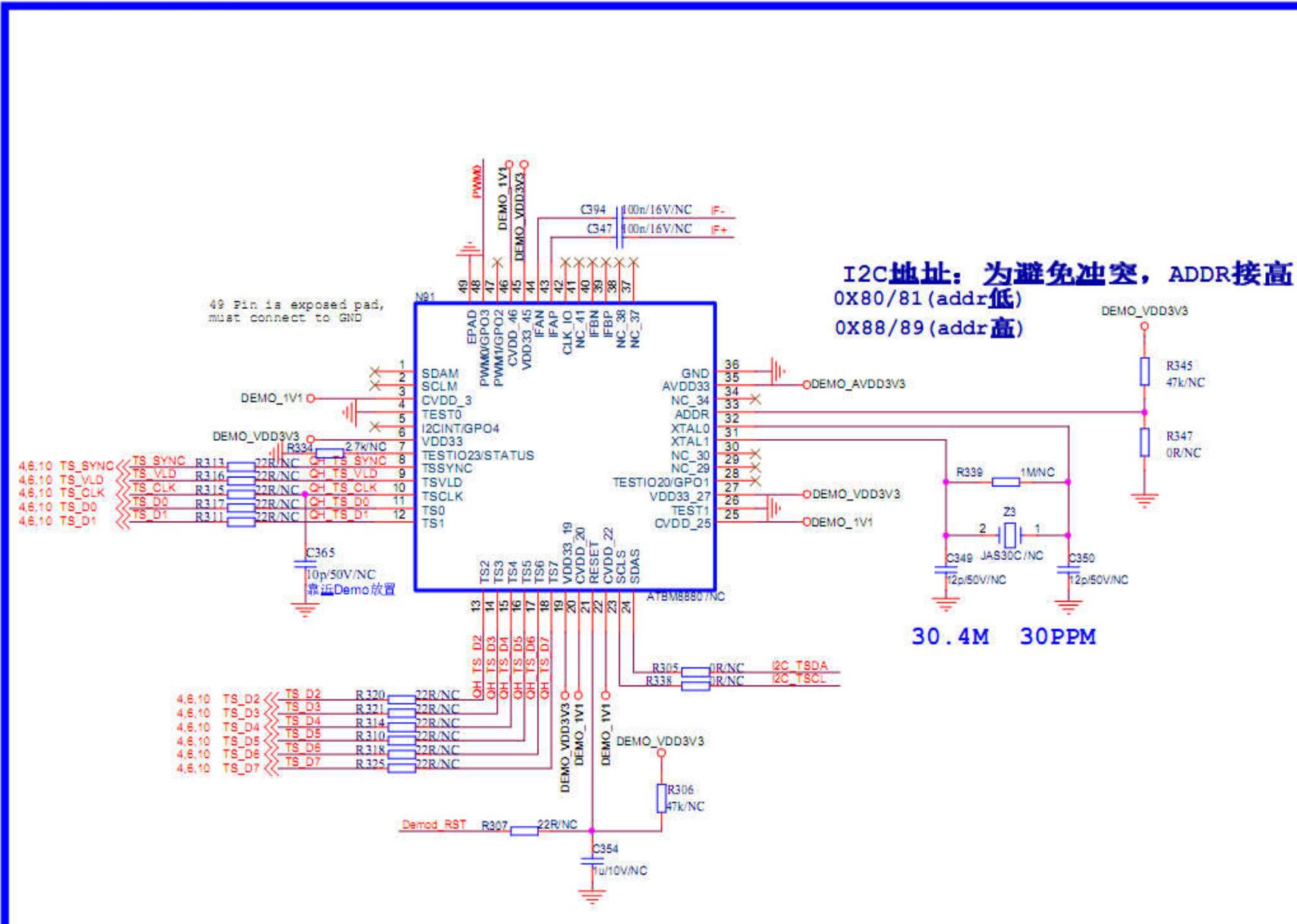


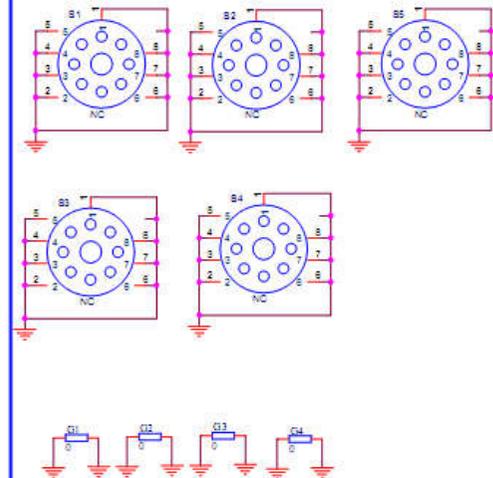
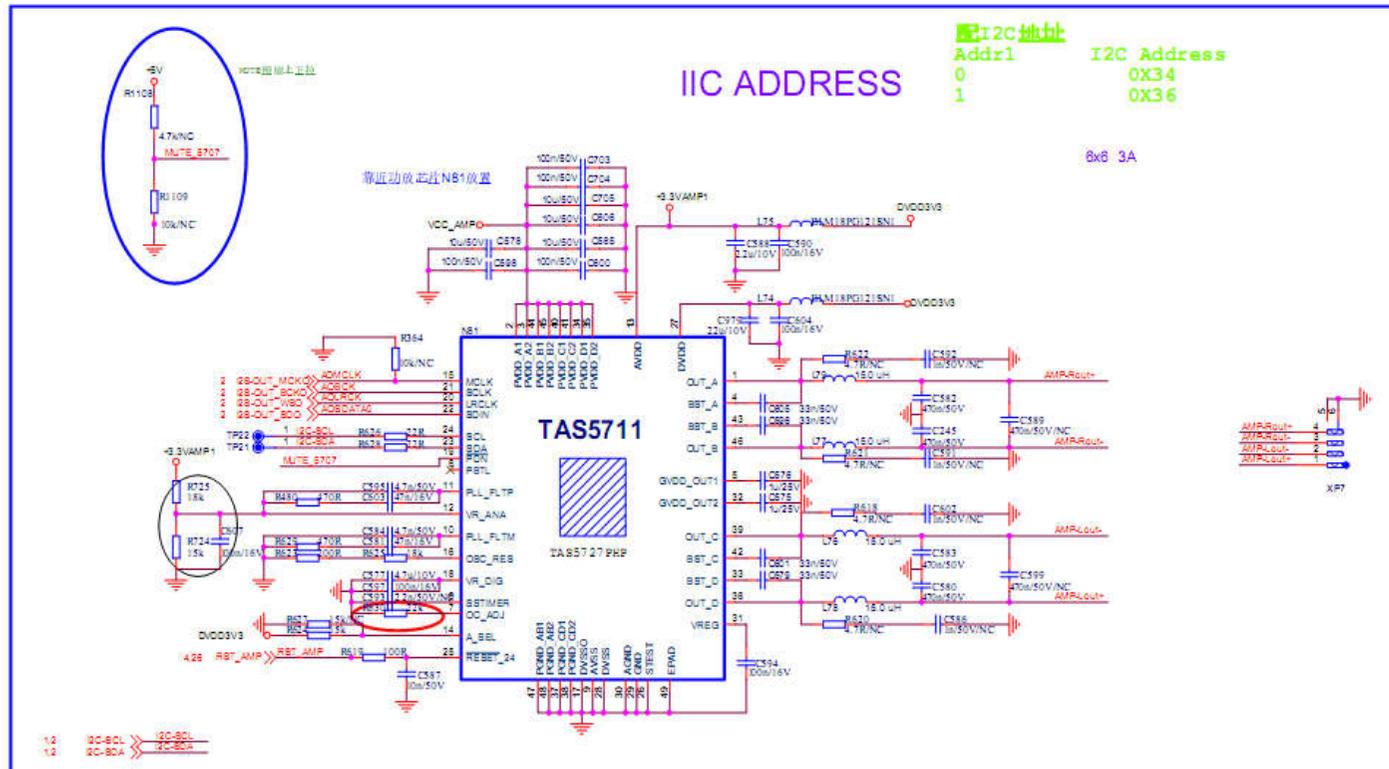
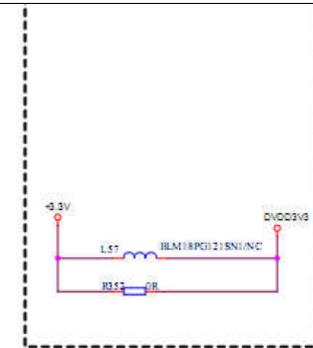
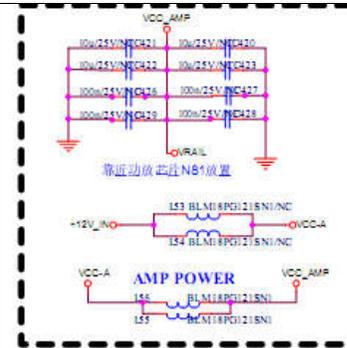
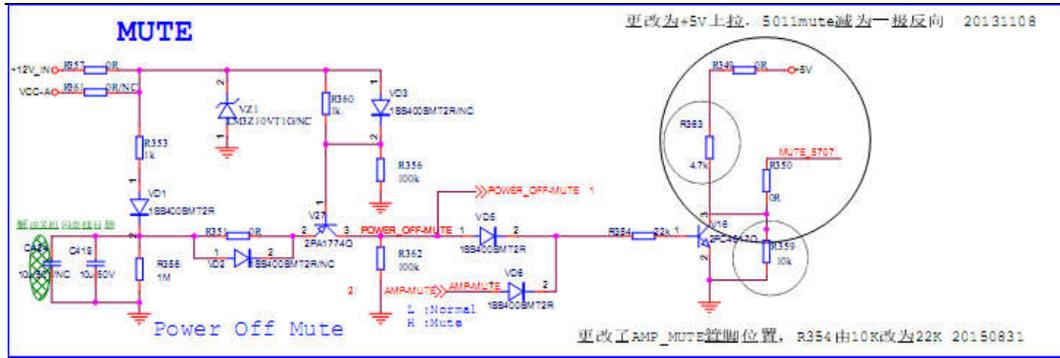
4.0.10
4.0.10
4.0.10
4.0.10

POWER



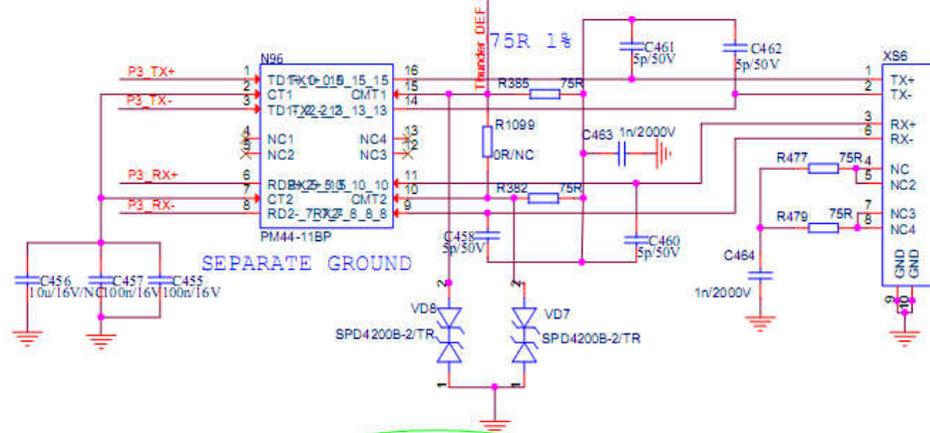
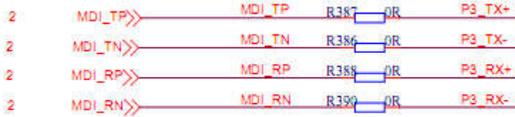
DEMOD 电路





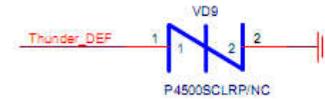
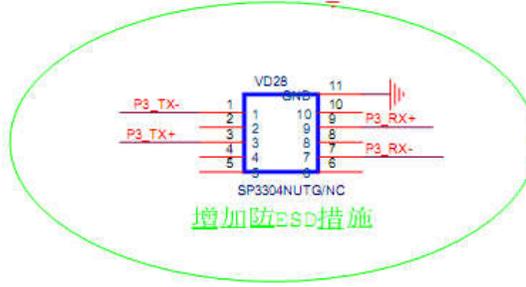
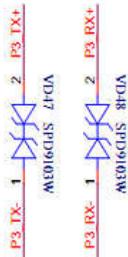
If need to use MDC/MDIO, then R601\R650 must load 1.5K ohm.

NET



立式不带灯铁壳: 1144736
立式不带灯不带铁壳: 1144396

用无灯无铁壳物料 10.15



四、电源板原理说明

本机型采用电源板组件 RSAG2. 908. 6570-03。

A、产品介绍：

6570 电源板由 100V-240V 交流电压输入，提供 4 路输出：

主板所需的 12V，功放所需的 16V，以及四路 LED 驱动电压输出。

主要性能指标：

- 1、电源应用范围：交流 100V~240V 50Hz/60Hz
- 2、电源最大输出功率：Pout=180W
- 3、电源额定输出功率：Pout=150W
- 4、接口：开发中心标准接口

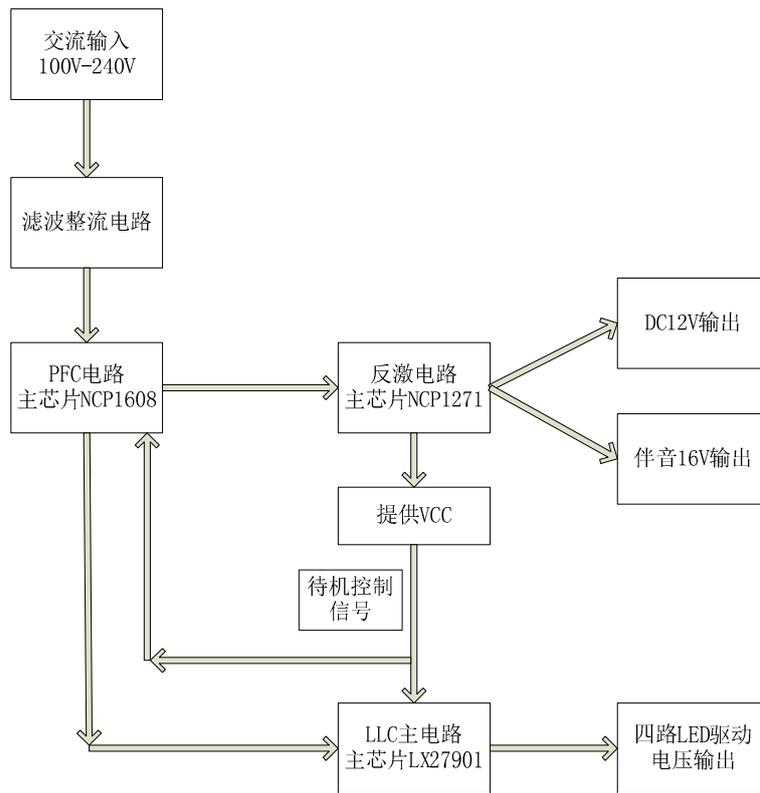
电源输出规格如下：

输出电压	误差范围	电压纹波	输出电流		
			最小值	典型值	最大值
16V	-0.5V~+2V	300 mV	0A	1A	1.5A
12V	±0.5V	100mV	0A	2A	4A
LED 驱动	-	-	0mA	190mA	200mA

B、方案概述

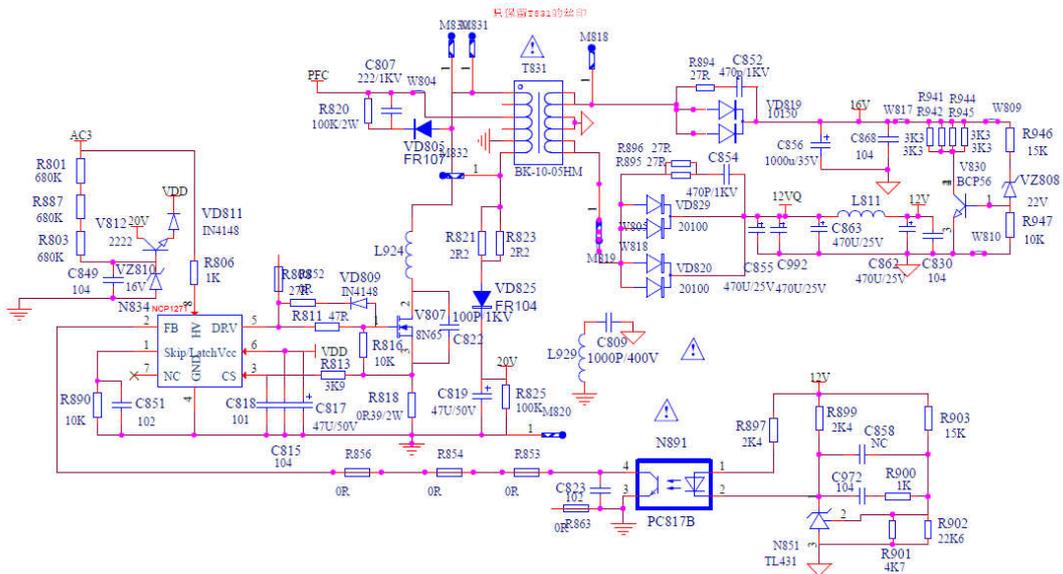
电源工作原理和结构框架图如下：

100V-240V 交流电压输入后，反激电路首先启动，12V 和 16V 输出，12V 提供给主板待机电路。当主板发送待机启动信号给电源板 SW 端子后，反激电路分别提供 VCC 给 PFC 电路（功率因数校正电路）控制芯片 NCP1608 和 LLC 电路控制芯片 LX27901。PFC 电路首先启动，输出 380V 直流电压；当 PWM 端子电压为高时，LLC 电路启动，输出四路恒流的 LED 驱动电压将 LED 背光点亮。



C、分部原理说明

(一)、反激电路



反激电路主控芯片采用的新一代的固定频率电流型反激变换式PWM控制器NCP1271，它集成了高压启动，低待机功耗，特别是专利的软跨越技术，可以实现最低待机功耗，并保持无音频噪声。其各个引脚的功能如下：

脚 1(Skip/Latch) 用于跳跃周期的调整, 当该脚所加电压高于 8.0 V 时, 控制芯片被关断。

脚 2(FB) 反馈端。接光耦中的集电极, 正常调整时 FB 的电压被拉低。如果其电压低于(Skip)脚 1 的电压, 则软跳跃周期方式被激活。如果其电压大于 3 V 持续 130 ms, 则控制芯片进入故障模式。

脚 3(CS) 初级开关管电流传感, 用于内部 PWM 调节。最大初级电流由式 $I=1.0 \text{ V}/R_{cs}$ 所决定, R_{cs} 为传感电阻。所加的电阻 R_{ramp} 用于内部电流斜坡补偿的改进系统的稳定性。

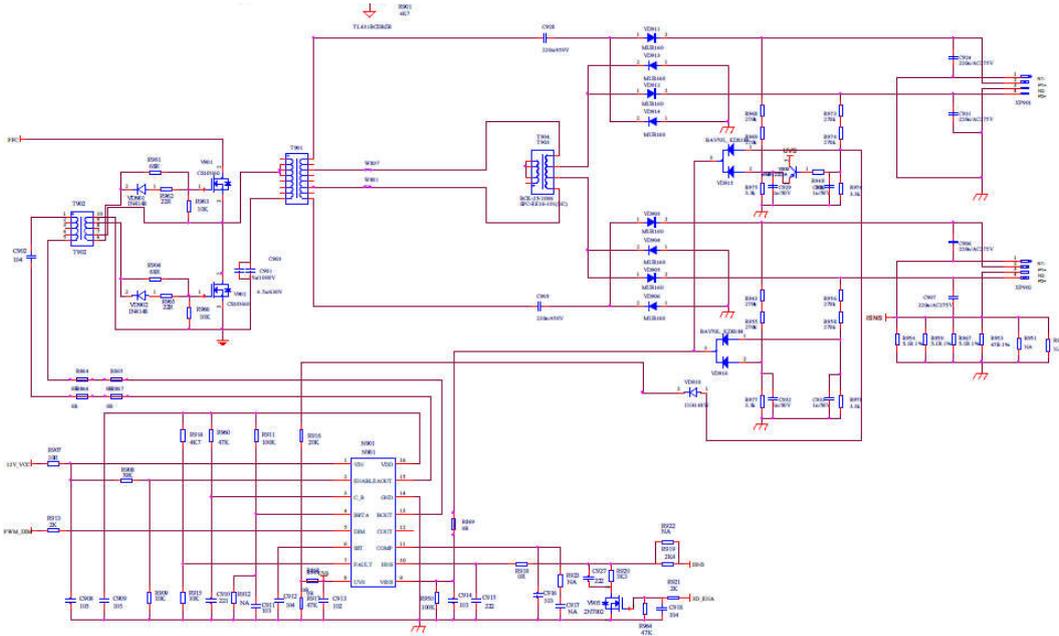
脚 4(GND) 控制芯片接地脚。

脚 5(Drv) 输出驱动。用于驱动 MOSFET 功率开关。

脚 6(Vcc) 控制芯片供电脚。芯片工作电压范围 10~20 V, 起动电压阈值 12.6 V, 具有欠压锁定功能。

脚 8(HV) 高压输入端。该脚具有以下功能:
(1)实现低功耗起动;(2)加倍打呃故障模式;(3)锁定关断记忆;(4)当对地短路时保护控制芯片。

(三)、LLC 电路



随着开关电源的发展，软开关技术得到了广泛的发展和应⤵用，已研究出了不少高效率的电路拓扑，主要为谐振型的软开关拓扑和 PWM 型的软开关拓扑。近几年来，随着半导体器件制造技术的发展，开关管的导通电阻，寄生电容和反向恢复时间越来越小了，这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说，如果设计得当，能实现软开关变换，从而使得开关电源具有较高的效率。

LLC 谐振电路，是我们现在所说的 LLC 谐振半桥电路的一个通俗的叫法，由于谐振时由于有两个 L 及一个 C 发生谐振，故称 LLC 电路，因此并非是三个英文单词首字母的缩写。

下图给出了 LLC 谐振变换器的电路图和工作波形。图 3 中包括两个功率 MOSFET (S1 和 S2)，其占空比都为 0.5；谐振电容 Cs，副边匝数相等的中心抽头变压器 Tr，Tr 的漏感 Ls，激磁电感 Lm，Lm 在某个时间段也是一个谐振电感，因此，在 LLC 谐振变换器中的谐振元件主要由以上 3 个谐振元件构成，即谐振电容 Cs，电感 Ls 和激磁电感 Lm；半桥全波整流二极管 D1 和 D2，输出电容 Cf。

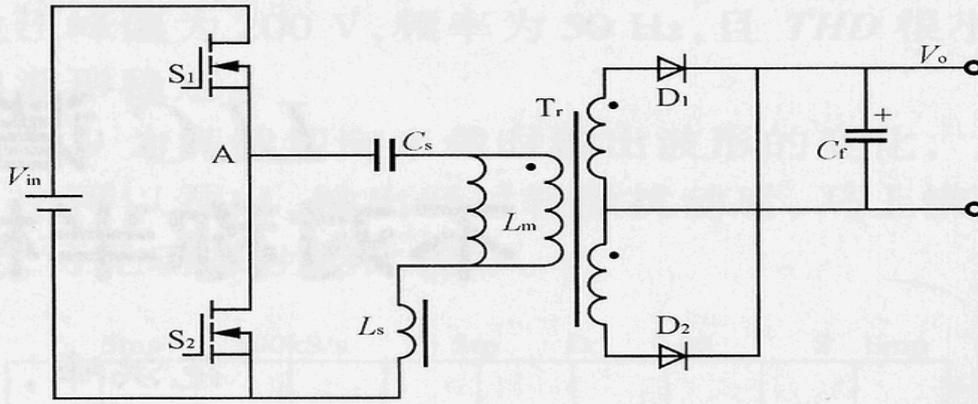


图3 LLC 谐振变换器

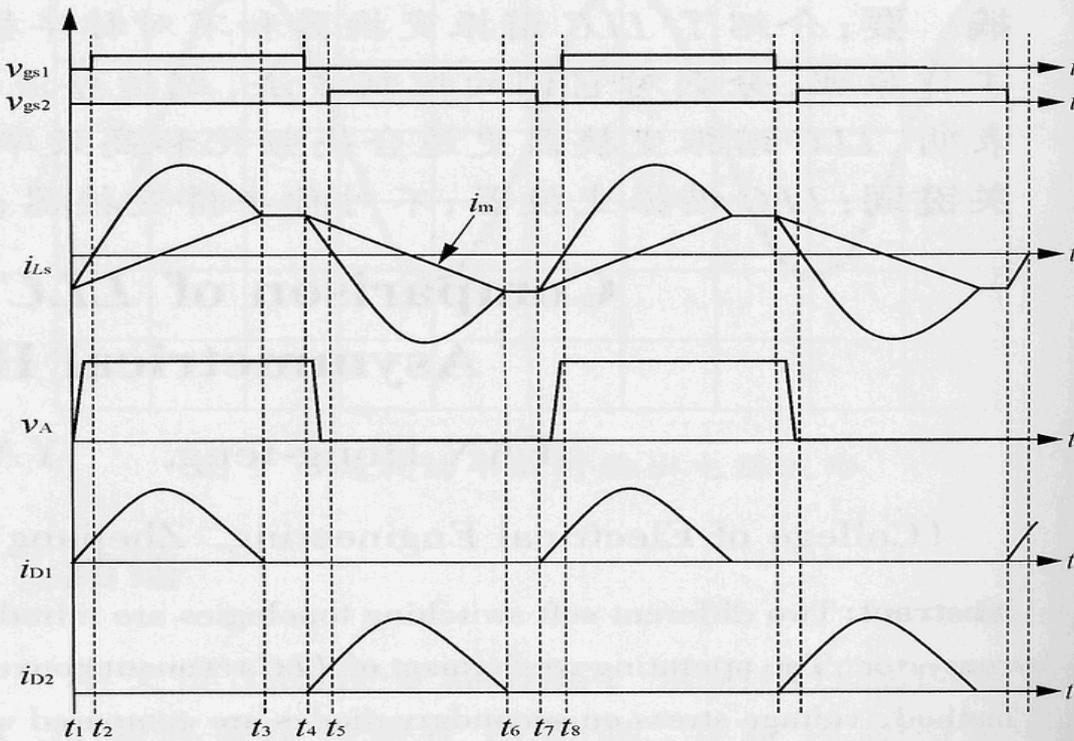


图4 LLC 谐振变换器的工作原理

LLC 变换器的稳态工作原理如下。

- 1、(t1, t2) 当 t=t1 时, S2 关断, 谐振电流给 S1 的寄生电容放电, 一直到 S1 上的电压为零, 然后 S1 的体二极管导通。此阶段 D1 导通, Lm 上的电压被输出电压钳位, 因此, 只有 Ls 和 Cs 参与谐振。
- 2、(t2, t3) 当 t=t2 时, S1 在零电压的条件下导通, 变压器原边承受正向电压; D1 继续导通, S2 及 D2 截止。此时 Cs 和 Ls 参与谐振, 而 Lm 不参与谐振。
- 3、(t3, t4) 当 t=t3 时, S1 仍然导通, 而 D1 与 D2 处于关断状态, Tr 副边与电路脱开, 此时 Lm, Ls 和 Cs 一起参与谐振。实际电路中因此, 在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。

4、(t4, t5) 当 $t=t_4$ 时, S1 关断, 谐振电流给 S2 的寄生电容放电, 一直到 S2 上的电压为零, 然后 S2 的体二极管导通。此阶段 D2 导通, Lm 上的电压被输出电压钳位, 因此, 只有 Ls 和 Cs 参与谐振。

5、(t5, t6) 当 $t=t_5$ 时, S2 在零电压的条件下导通, Tr 原边承受反向电压; D2 继续导通, 而 S1 和 D1 截止。此时仅 Cs 和 Ls 参与谐振, Lm 上的电压被输出电压箝位, 而不参与谐振。

6、(t6, t7) 当 $t=t_6$ 时, S2 仍然导通, 而 D1 和 D2 处于关断状态, Tr 副边与电路脱开, 此时 Lm, Ls 和 Cs 一起参与谐振。实际电路中因此, 在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。

LLC 谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的, 也就是在不同的输入电压下它的占空比保持不变, 与不对称半桥相比, 它的掉电维持时间特性比较好, 可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。

D、常见故障分析

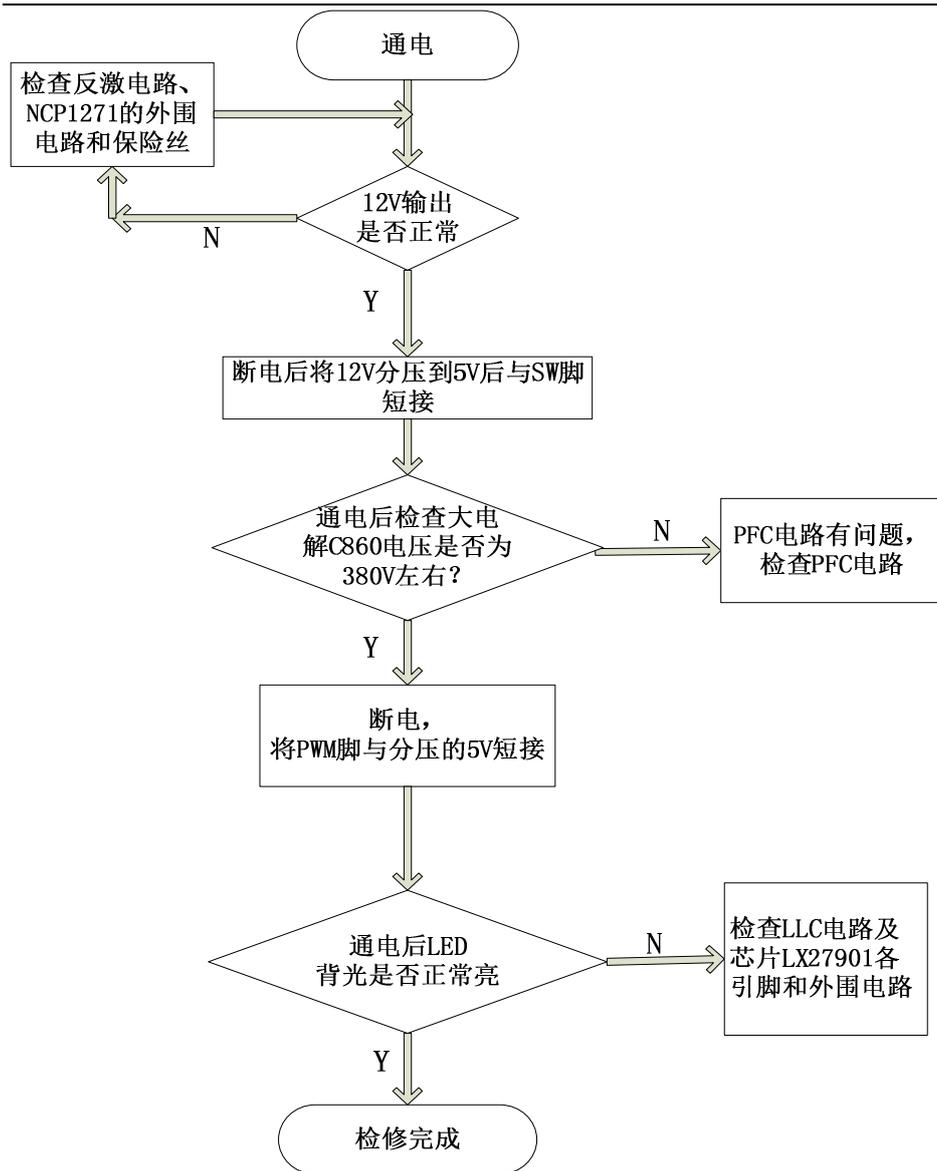
PFC 电路简单维修介绍: PFC 部分损坏, 一般表现为大电解 C860、C865 上的电压不正常, 不在 370V-400V 范围内。如果电解上的电压远高于 380V, 一般来说是 NCP1608 FB 端 (1 脚) 出了问题, 此时重点查看 R833、R838、R839、R840、R844 这几个电阻是否漏焊或损坏, 如果没有, 则可能是芯片的 1 脚发生故障, 需要更换芯片。如果电压远小于 380V (310V 左右), 则可能是 PFC 部分没有工作, 此时首先判断芯片 Vcc (8 脚) 电压是否正常, 如果不正常, 可能问题不是出在 PFC 上, 需要顺着 Vcc 供电这一路向前一步步确认下去, 直到找到故障点。如果 Vcc 正常, 则就要看别的脚的外围元件有无问题, 找到故障点, 如果各脚的元件无问题, 则可能是芯片损坏了。Vcc 是查问题的很重要的一步, 这是判断问题来源的关键。

LLC 电路简要维修介绍: LLC 电路不正常时主要表现为背光不亮, 此时可按如下步骤进行检修:

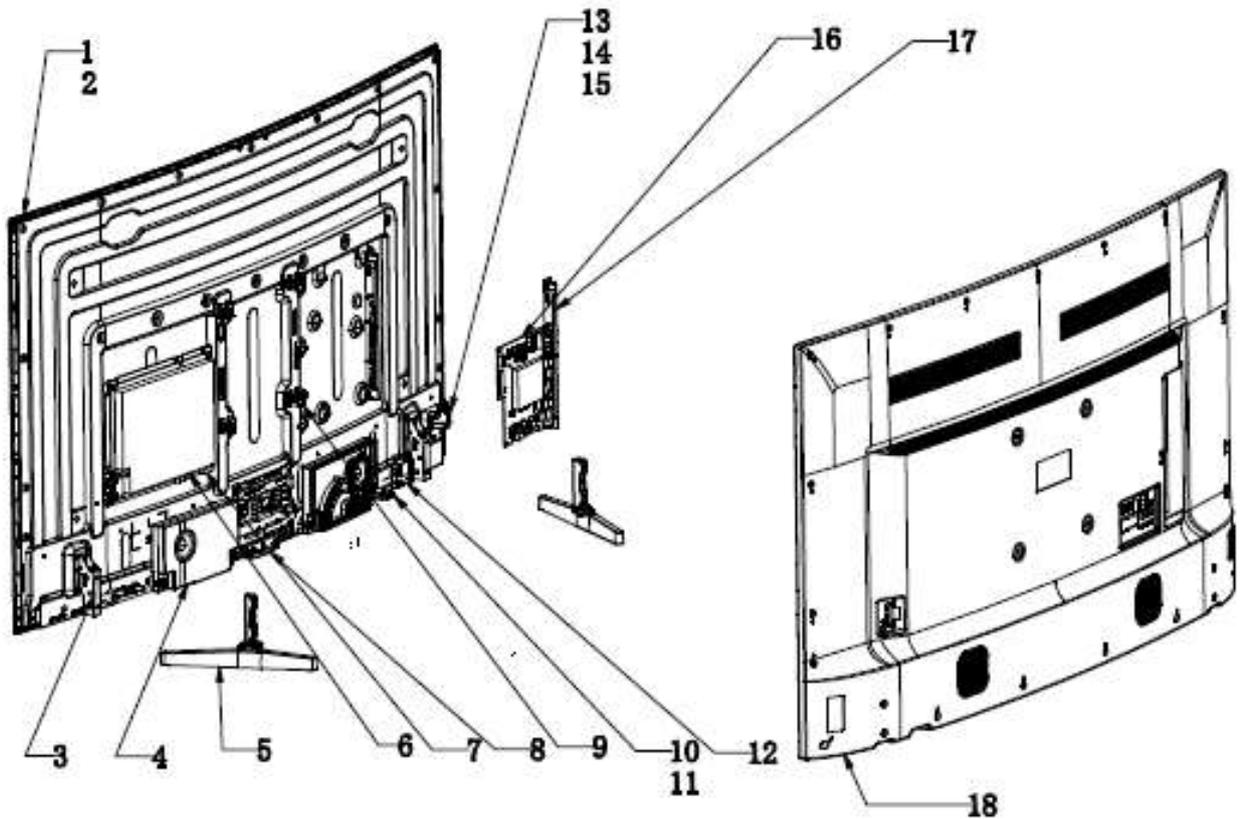
- 查看主板产生的 SW 和 PWM 信号电压是否正常 (正常都为高电平);
- PFC 电压是否正常 (370V-400V 左右)。如不正常 (310V 左右), 则 PFC 电路未启动, 参考 PFC 电路维修介绍;
- LX27901 Vcc 电压是否正常。如不正常, 则检查 Vcc 供电电路;
- LX27901 其他引脚及其外围器件是否正常。

E、单板检修流程

检修流程图:



五、产品爆炸图及明细



18	后壳	1	RSAG8.074.3355	
17	端子板	1	RSAG8.081.1487	
16	主板组件	1	RSAG2.908.6935-04	
15	按键板组件	1	RSAG2.908.6186-04	
14	按键支架	1	RSAG8.078.4159	
13	按键	1	RSAG8.335.0239	
12	WIFI模块	1	WCBN4511R(32)	
11	遥控板组件	1	RSAG2.908.6727-08	
10	导光件	1	RSAG8.640.0491	
9	支架组件	4	RSAG6.150.1362	
8	装饰件组件	1	RSAG6.434.0138	
7	绝缘垫片	1	RSAG8.600.0969	
6	电源板组件	1	RSAG2.908.6570-03	
5	底座组件	2	RSAG6.121.0868	
4	内置音箱	2	VII118200-1776 G-01L VII118200-1776 G-01R	
3	金属支架	2	RSAG8.036.4977 RSAG8.036.4978	
2	液晶屏	1	HR550IUC-B52	
1	前壳组件	1	RSAG6.179.1720	
序号	名称	数量	代号	备注

六、软件升级方法

A、Mstar 机芯调试工具及安装方法介绍

Mstar 机芯平台的开发调试和维修调试工具主要是通过串口进行的。

下图是通用的调试和维修使用工具，该工具为 Hisense 自行研发，支持 MTK、Mstar 等不

同平台。

结合软件工具 SecureCRT.exe 一并使用，该调试方案适合 Mstar 方案内销全系列，通常用于 Log 信息监控或进行指令交互调试。

工具的 USB 端连接在电脑端，电视机端根据预留的端子进行选择，近几年由于越来越多的电视机取消了 VGA 物理端子，目前大都改用耳机口进行连接，在实际的使用中请恰当的使用，下图 1-1 就是实际工具外形和相关说明。

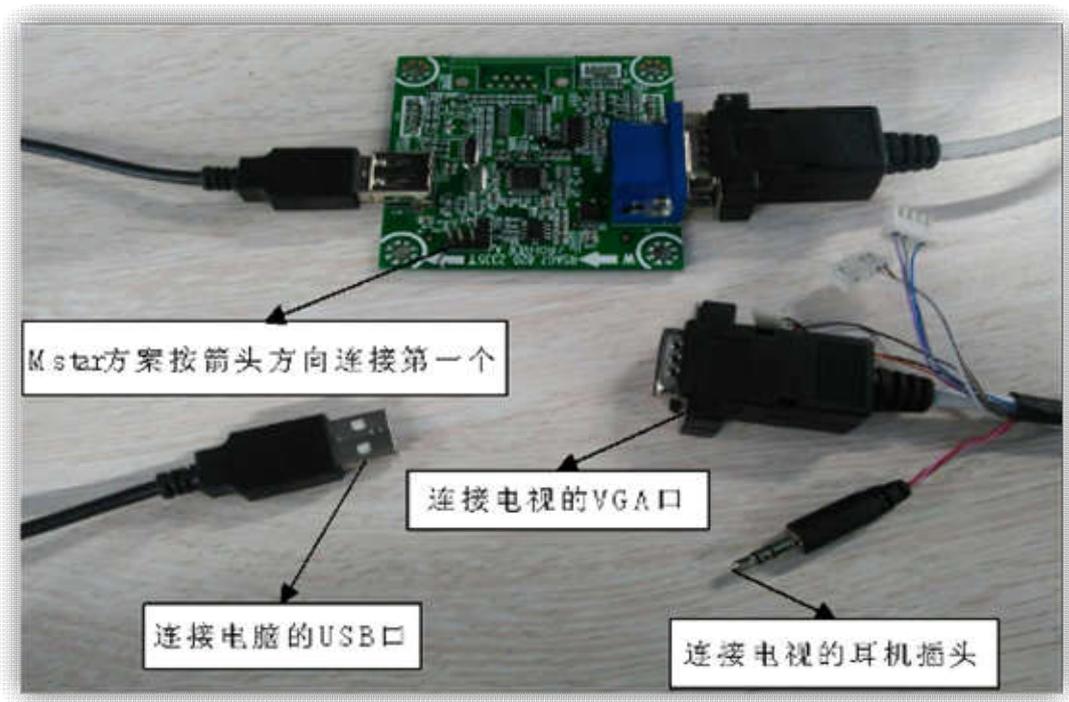


图 1-1 串口调试工具及连接方式

调试工具和电脑初次连接时系统会识别设备并提示，点击下一步将 CP210X 的安装目录加入扫描目录，Windows 会找到驱动自动安装（需要安装两次驱动，会有再次安装的提示）。

建议在 WinXP 系统下安装驱动程序，安装过程中选择默认安装即可。如系统检测不到硬件则可以在 我的电脑→属性→硬件→其他设备 里发现驱动，安装两次即可。再建立 SecureCRT.exe 打印窗口的快捷方式即可监控 log 或进行调试（注意：安装了 Mstar 的驱动只能调节 Mstar 方案的机器，且跳线只能放在第一个针上，调试其他方案的机器可能不兼容）



NewDebugDrivers_V
01 (MStar_Win7).

驱动安装包如下：[..\Mstar 串口驱动.rar](#)。

B、升级方法介绍

Mstar 方案升级方式分两类：1. U 盘升级；2. 网线升级（不推荐）。

U 盘升级又分为正常升级和强制升级。

U 盘升级中的正常升级就是在电视机系统能正确的判断识别 U 盘中的升级程序信息，并作出提示信息，用户操作点击确定后系统自动开始升级；而强制升级是指电视在上电过程中按指定的按键或使用串口命令使电视检测到 U 盘有相关的升级文件从而开始程序升级过程。升级时请确保 U 盘已使用 FAT32 格式进行格式化并预留 1G 左右的存放空间。

先介绍**自动升级**，不同方案升级的方式不同，目前 MTK 方案按升级方式可以分为三类：

1、自动升级

该方法适用于电视能正常开机，并可以正常进行USB升级的情况。

芯片系列	升级文件(文件夹名 TargetHis)	对应的强制升级方法
828	His828Upgrade.bin——主程序 (包含 boot loader)，其余下面 文件非专业人士不建议升级！ His3700FRC.bin His6M60FRC.bin His4030Sc.c.bin HisEP64Blu.bin version.txt	开机不停地按音量减键升级
918	His918Upgrade.bin ursa.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
628	His628Upgrade.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
881 改名为 880 系列	机型名.bin version.txt	开机不停地按音量减键升级。
901	MbootUpgrade.bin His901Upgrade.bin ursa.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
801	usb.bin mboot.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。
6180	机型名.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。
982B	usb.bin mboot.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。

表 2-1

其中version.txt下为软件版本号，版本号前面的机型名和要升级的电视的机型名相同，具体版本号格式可进工厂查看，如下：



图 2-1 version.txt内容

(2) 在电视机交流关机情况下插入U盘，注意只支持2.0 USB端口(828方案支持所有USB接口)，见图2-2。



图 2-2 升级U盘需插在USB2.0端口（白色端芯）

(3) 重新开启电视机，系统将自动进行升级。升级过程中将出现图 2-3 相关提示信息。

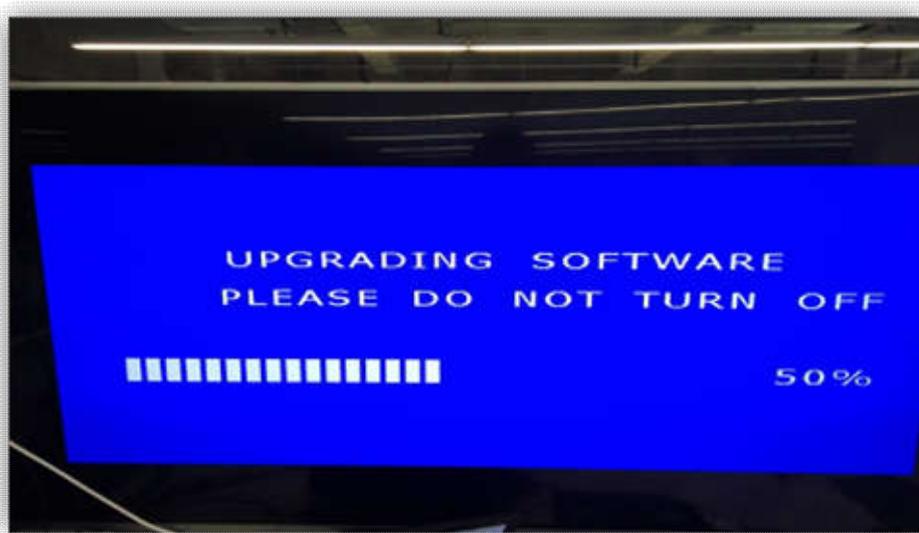


图 2-3 利用 USB 升级主机芯以及相关升级提示信息

2、强制升级

有两种，适用于没有电脑和升级工具或电视无法开机的情况，升级方法详情如下：

- 3) 把串口打印软件（如 CRT）断开
- 4) 双击打开 ISP_Tools，如下图 3.1。



图 3.1

- 5) 打开时需要先检查一下配置，对不符合的项进行更改，点击“Config”按钮，出现下图 3.2。

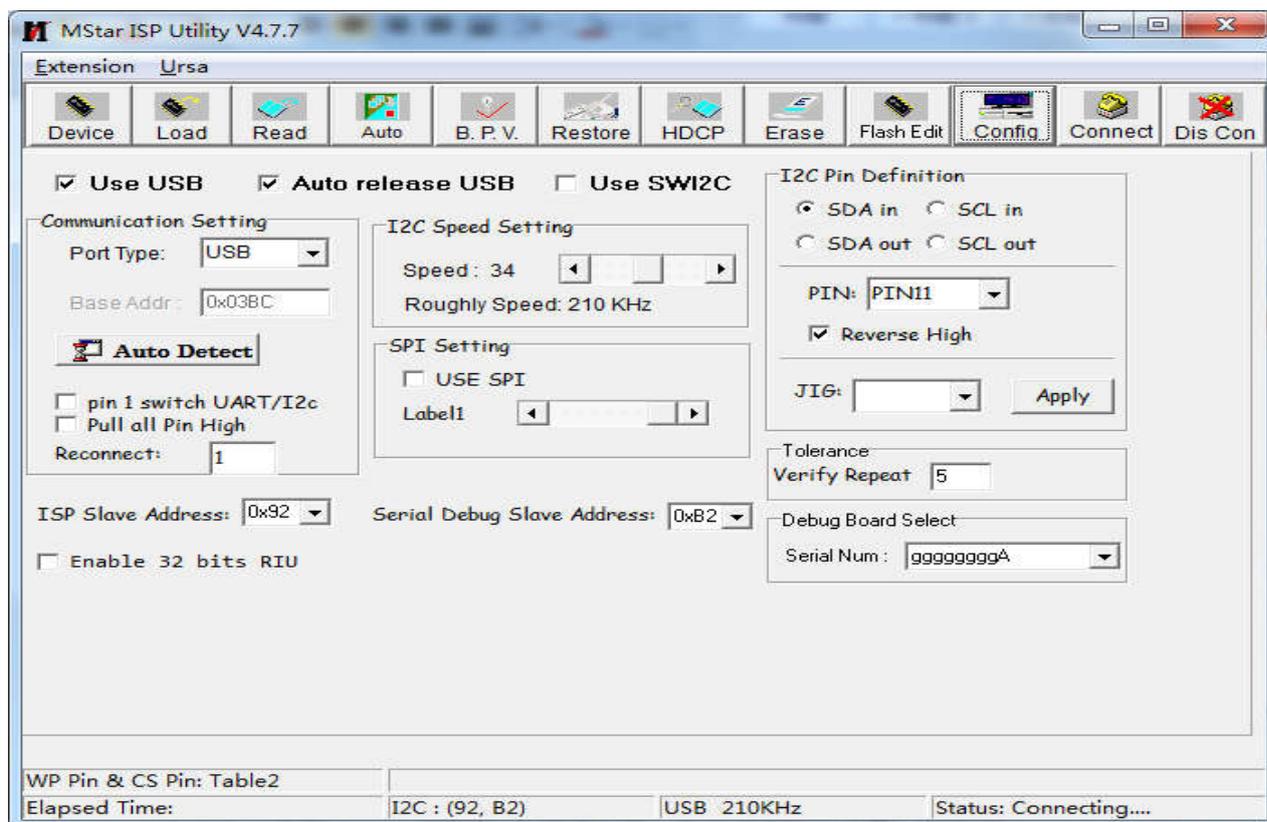


图 3.2

- 6) 将 Use USB 勾选，ISP Slave Address 选择 0x92，Serial Debug SlaveAddress 选择 0xB2，I2C Speed Setting 中的 Speed 调整到 34 就可以了（有问题可以适当下调到 25 左右），其他使用默认设置。如下图 3.3。

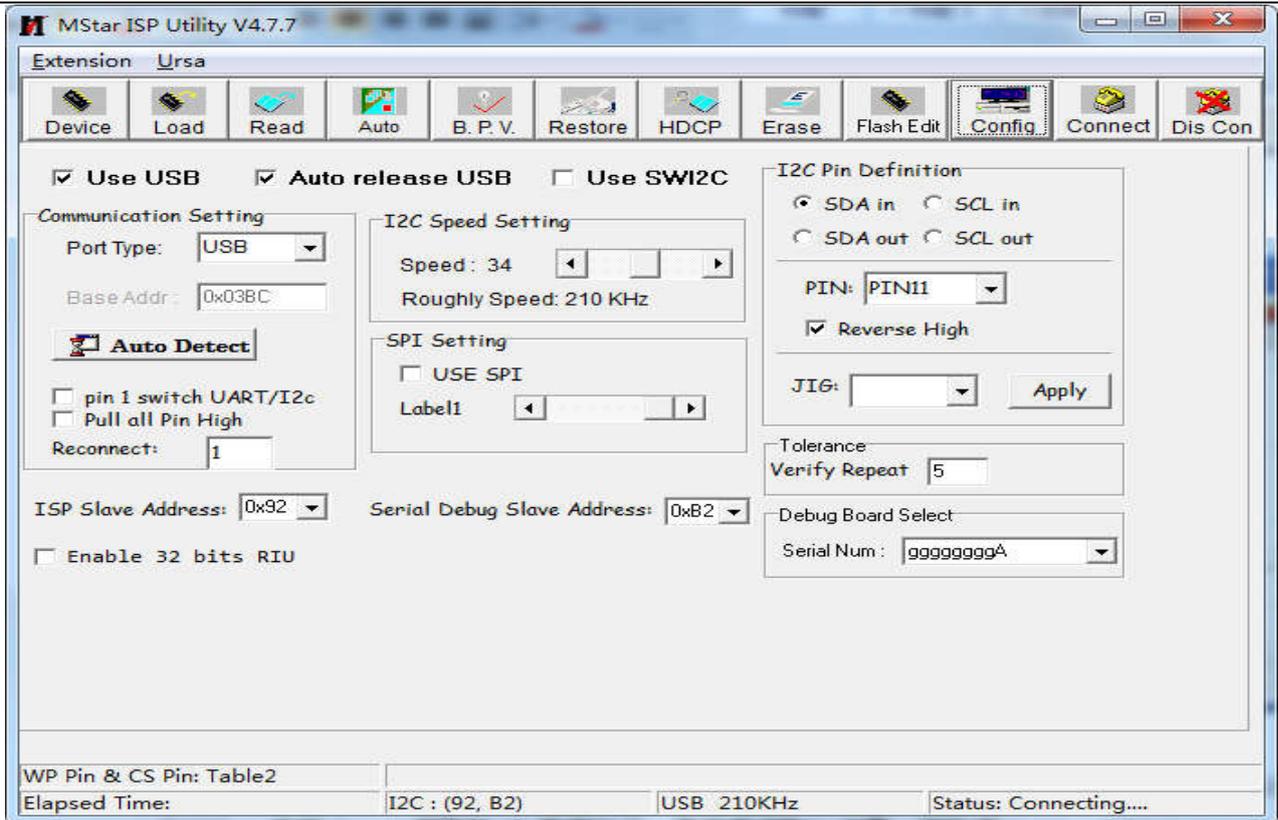


图 3.3

7) 属性设置后，点击“Read”按钮出现下图 3.4。

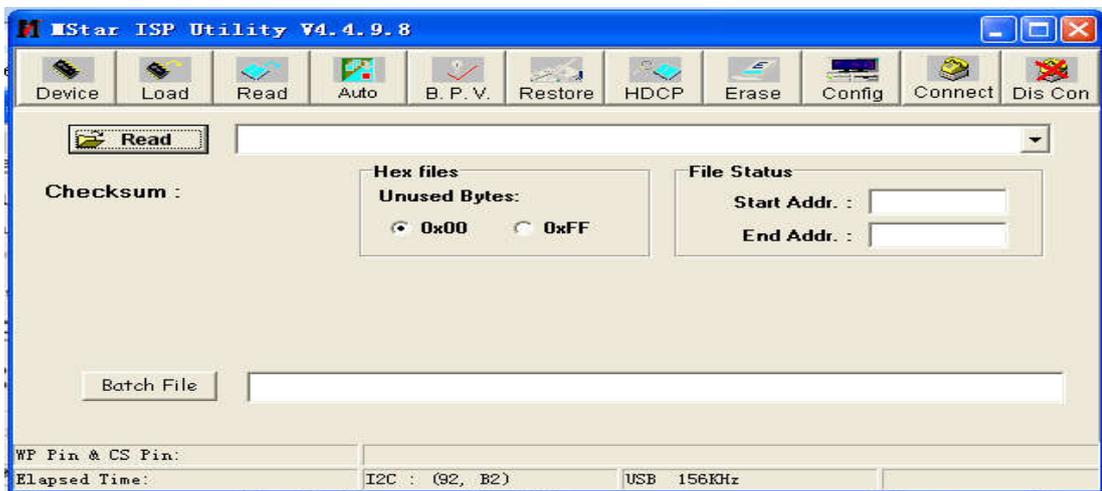


图 3.4

8) 点击“Read”按钮，弹出文件选择的对话框，找到我们用的 Mboot 的 bin 文件，点击“打开”，即可选择到我们要升级的 Mboot 文件，如下图 3.5。

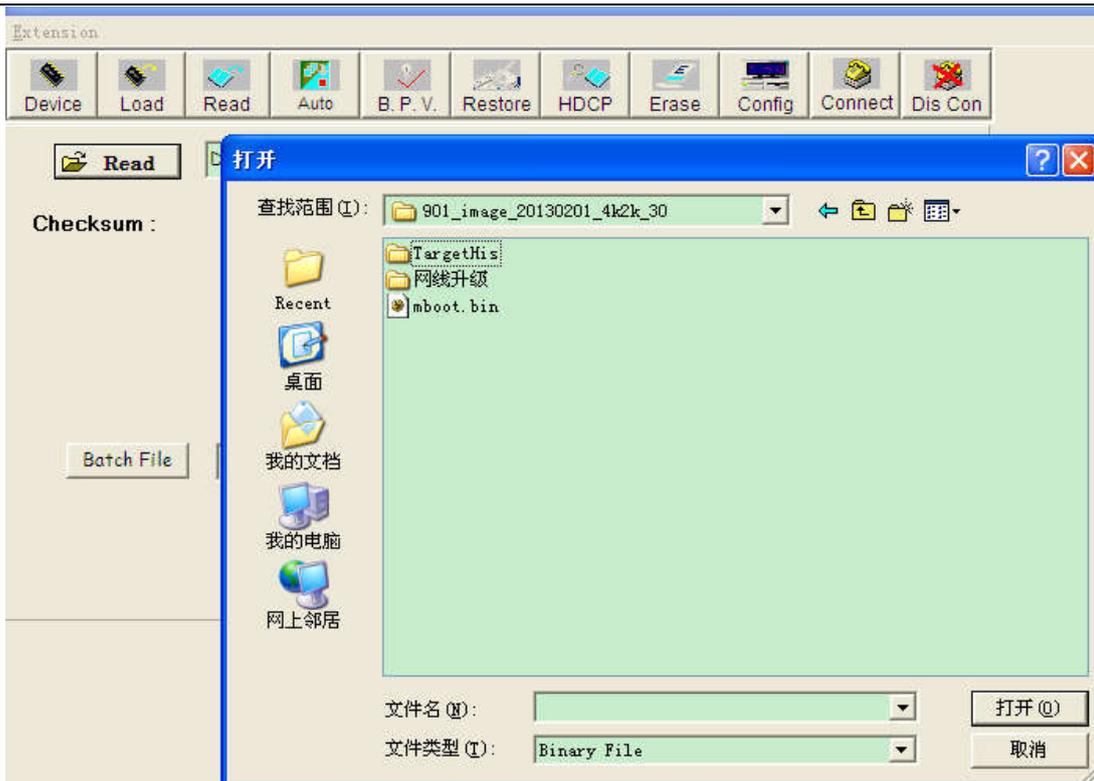


图 3.5

9) Mboot 文件选定后，点击“Auto”按钮，如下图 3.6。

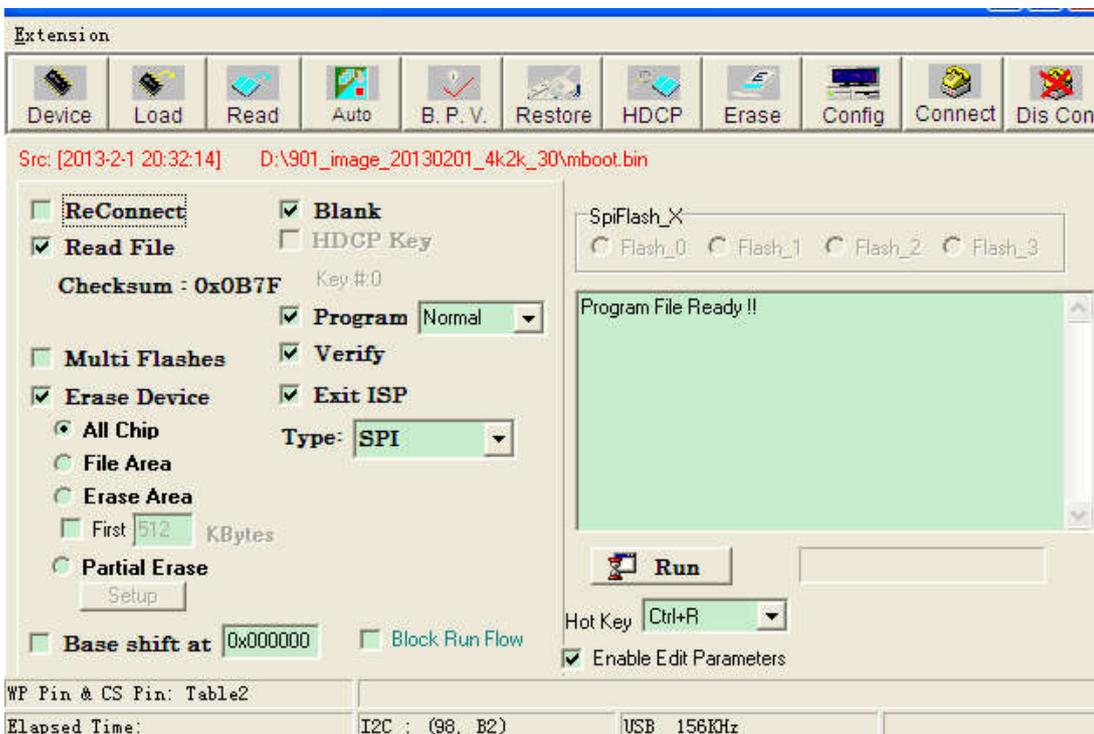


图 3.6

10) 可以看到红色字显示的即是我们刚才选择的 Mboot 的升级文件。

将 Reconnect 的“对号”去掉，勾选 ReadFile、Erase Device、Blank、Program、Verify、Exit ISP, 这样准备工作就完成了，下面是开始连接：打开电视的开关，同时点击“Connect”按钮（注：打开电视的开关的瞬间点击“Connect”按钮，这样连接的成功

率较高些), 连接失败会显示 “Can’ t Find the Device Type !!” 如下图 3.18, 这时需要重新连接, 有时需要多次连接, 连接成功如图 3.7 所示。

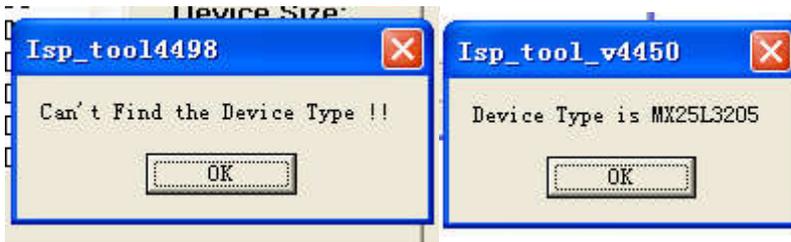


图 3.7

连接成功后, 就可以点击“Run”按钮开始烧写了, 烧写过程中可能会失败, 就需要重新烧写, 烧写成功会显示大号绿色字符串“PASS”, 这时 Mboot 就烧写完成了。

备注: 对于图 3.6 中 “Auto” 下的设置, 一般就可以成功升级; 特殊的, 也可以设置如下图 3.8 (即左栏选择 All Chip 模式), 这种设置方式, 烧写 Mboot 更为彻底, 少些时间要长一些。

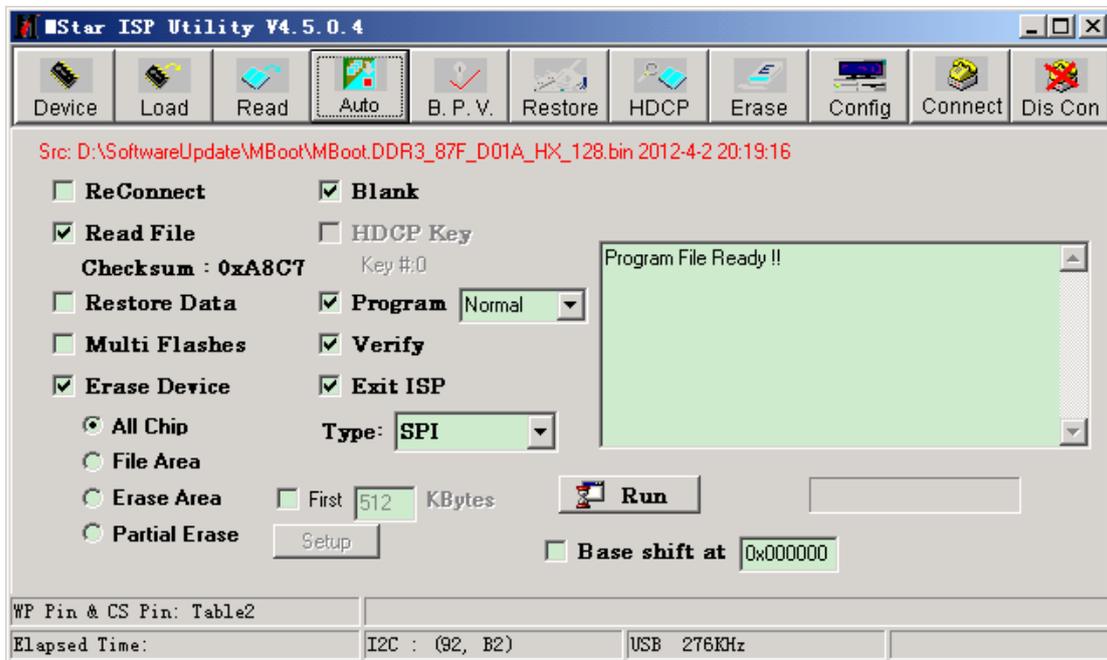


图 3.8

二、Mboot 烧写系列二: (此方案适用 628 方案)

烧写方法二基本同方法一, 只是文件的选择有差异, 差异步骤有:

步骤 7 改为: 点击下图红色 ATUO 界面, 选择 Type 为 eMMC 如下图。

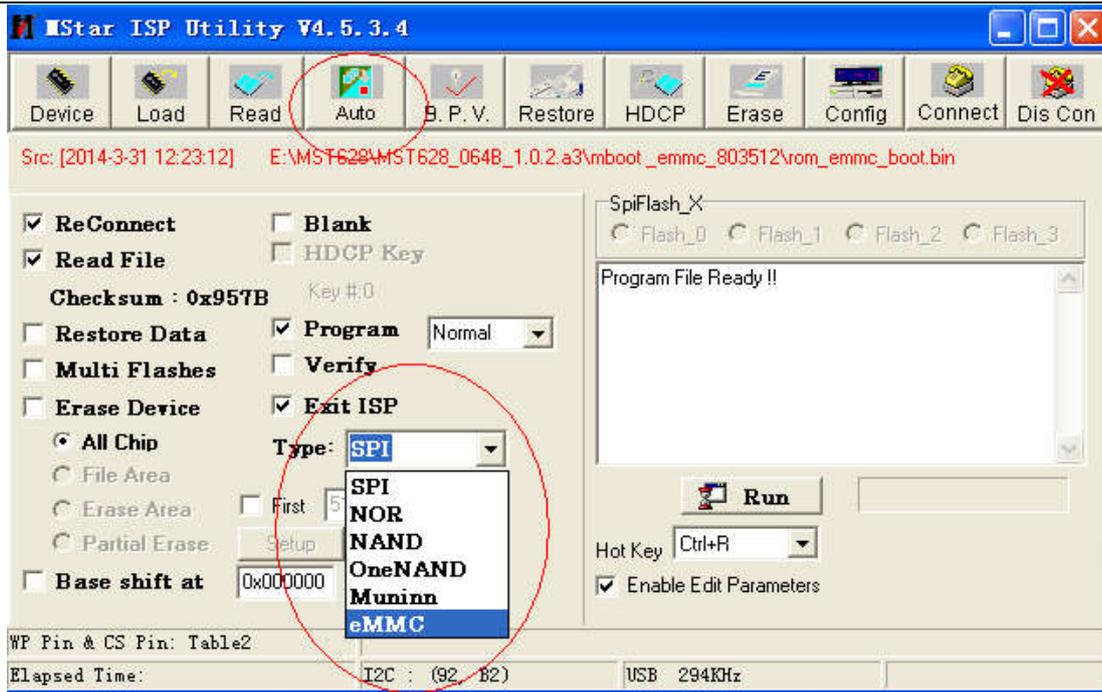


图 3.9

步骤 8 改为: 选择文件如下图:

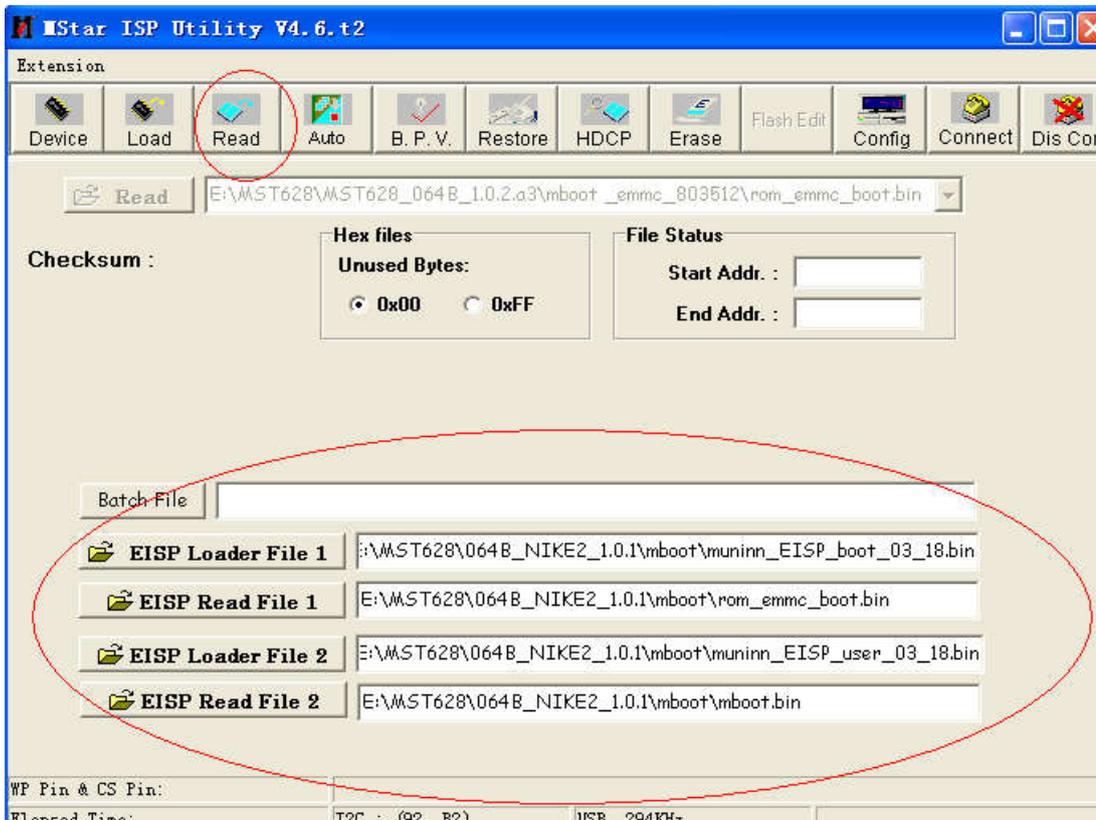


图 3.10

三、Mboot 烧写系列三: (此方案适用 918 方案)

配置方法参考下面压缩文件。



918 Boot From eMMC.rar

四、Mboot 烧写系列四：（此方案适用 828 方案）



教程：
How to write the MBoot to EMMC on :



用到的工具：
TV tool和烧写工具.rar

2、6M40 烧写：（只有 801, 901, 918 系列部分机型有 6m40 FRC 程序）

6M40 的烧写方法同 Mboot 的烧写方法基本相同，所用工具为 ISP_Tools，该工具的版本与烧写 Mboot 的工具版本不同，如图 3.21 的红色圈内部分所示。可以采用旧版本的 ISP_Tools 烧写 Mboot，但是 6M40 的烧写需要新版的 ISP_Tools（版本为 V4.5.3.7，最新版本已有 4.6.*，跟上面同样的工具）。点击“Config”按钮，将 ISP Slave Address 选择 0x98，Serial Debug SlaveAddress 选择 0xB2，如下图 3.11。

6M40 的烧写需要拆开机器后壳，将 mstar 工具的 usb 插入电脑的 usb 口，将另外一端的小的 4pin 口（三个白色的接口中，有两个 4pin 口，1 个 6pin 口，2 个 4pin 口中选择小的那个 4pin 口）接到电视主板上的 4pin 口上（两个白色 4pin 口中靠近边缘的那个）。打开 SecureCRT，并断开跟电视的连接。

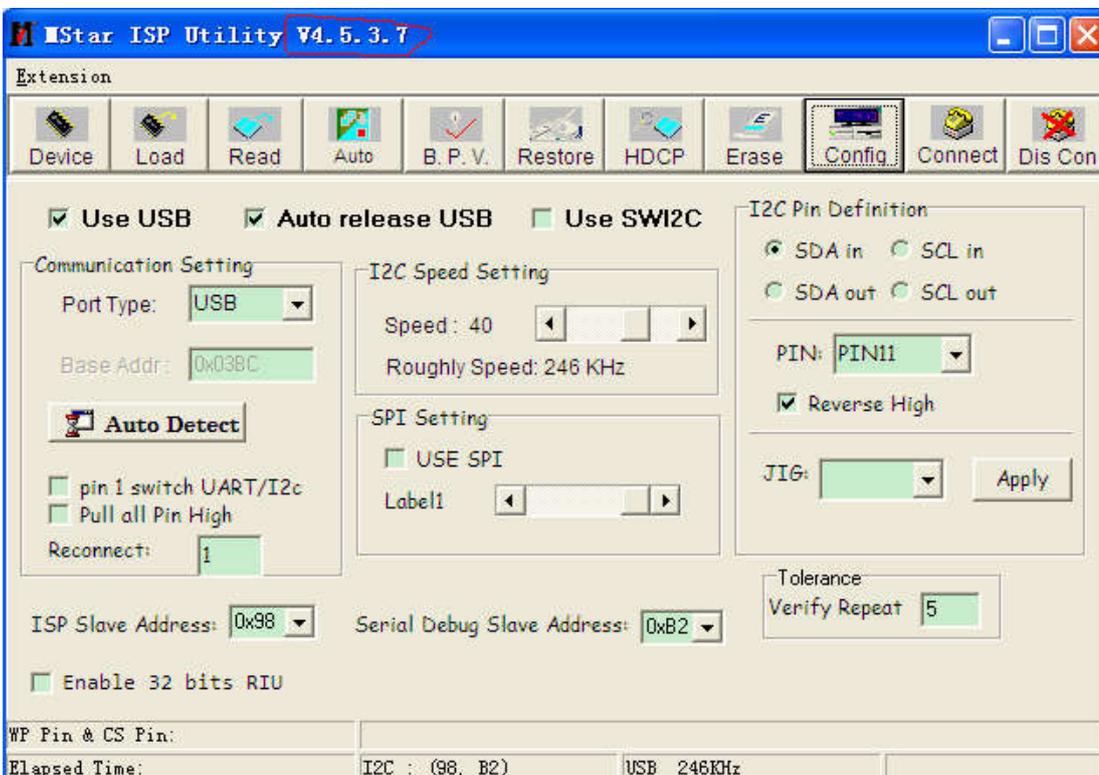


图 3.11

点击“Read”按钮，弹出文件选择的对话框，找到我们用的 6M40 的 bin 文件，点击“打开”，即可选择到我们

要用的 6M40 文件, 如图 3.12 所示。

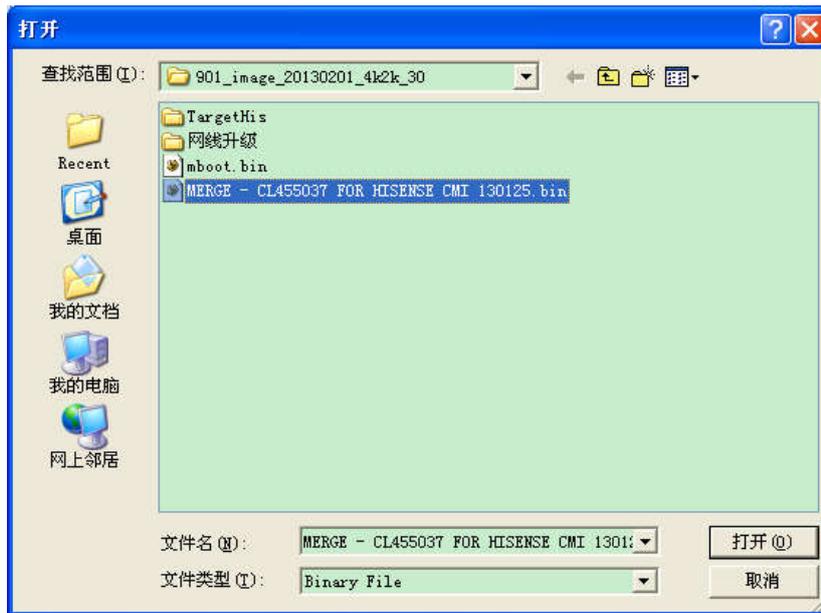


图 3.12

选择 Auto, 连接时不需要在打开电视开关的瞬间点击“Connect”按钮, 在电视开启的状态下, 直接点击 Connect 即可。连接成功后会有图 3.13 所示红色圈内所示的信息弹出。成功连接后点击 Run 开始烧写, 若烧写失败, 可适当调整 Config 中的 Speed, 烧写成功的界面如图 3.14 所示。

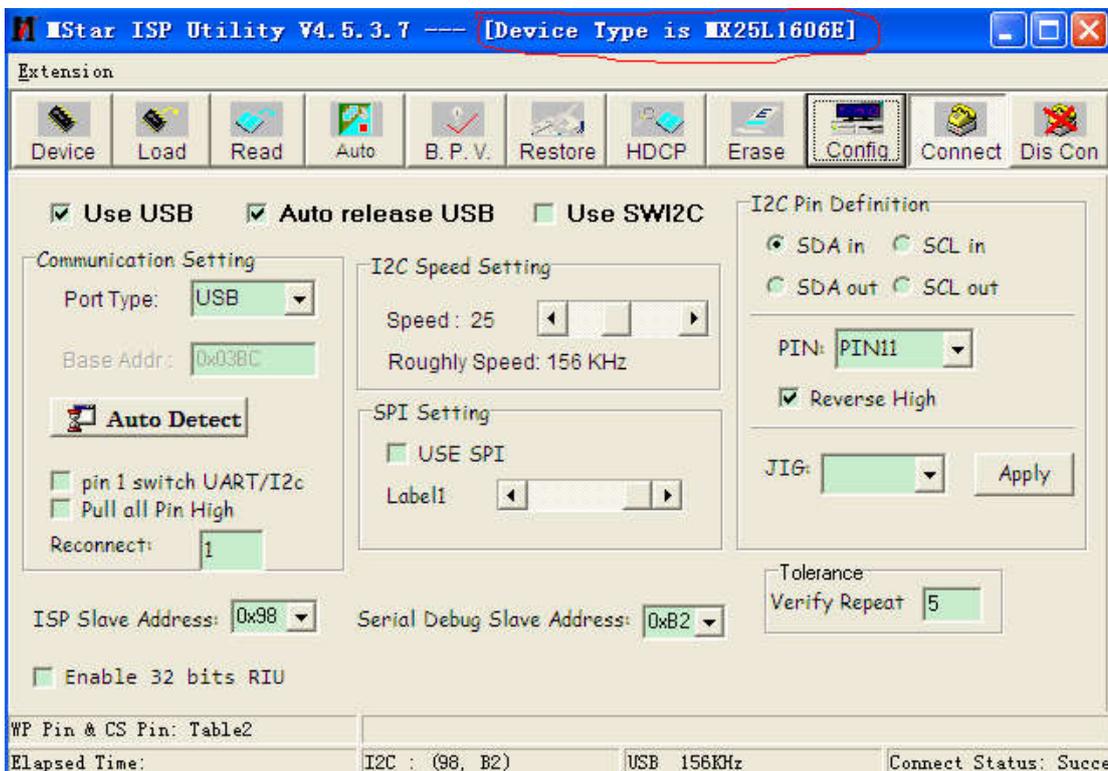


图 3.13

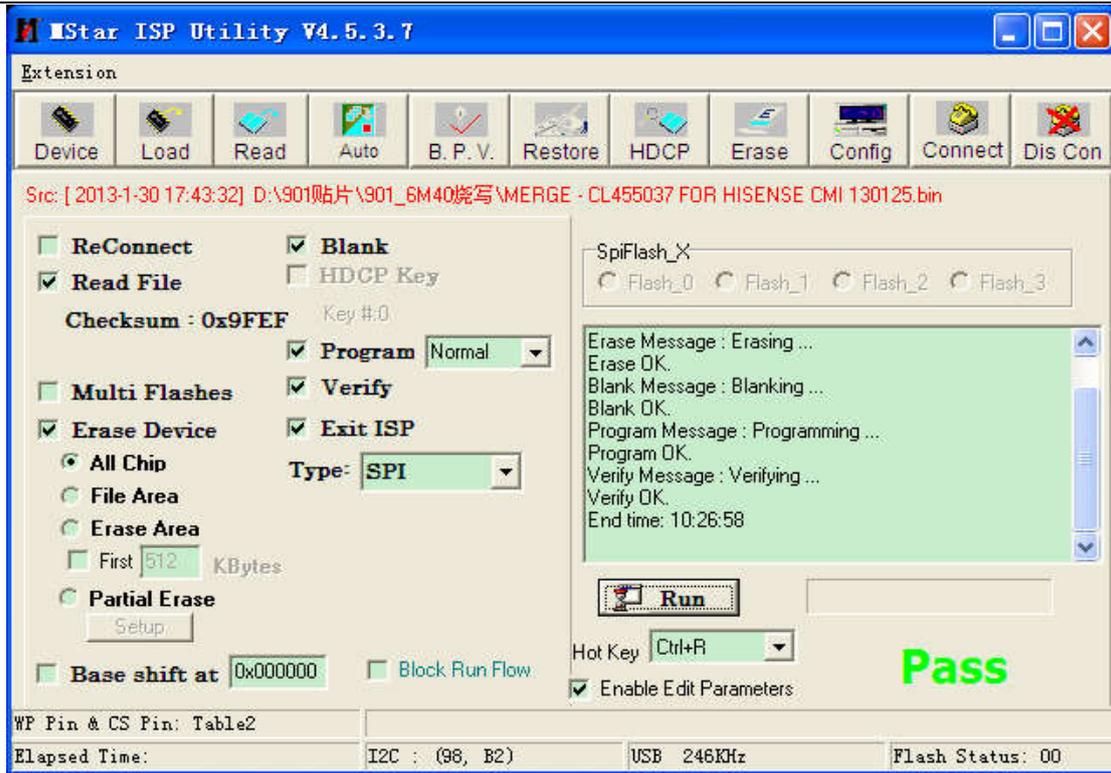


图 3.14

3、6M60 烧写：（828 系列部分机型有 6m60 FRC 程序）



6M60使用ISP
TOOL升级文档说明_

升级过程中简单问题判断：

- 1, 接串口看是否有打印信息，如果有说明 mboot 应该是好的；不好就需要用串口工具来升级 mboot
- 2, 打印停在：Edison# 下面，说明主程序不对，可以用网线升级，可以用 U 盘的强制升级模拟；最后进工厂清空下母块，确认下软件的版本号。
- 3、如何升级 FRC 程序：

在 Mstar 的平台中，一些机型搭载了 FRC 处理设备。FRC 一般有自己的程序。有如下几种方法支持 frc 的程序更新：

A、U 盘强制升级方案：（此方案只有从 918 后期的可以支持）

将 frc 升级文件更改成 urisa.bin 文件放置在 TargetHis 文件目录下，注意此时可以和主程序相关配置文件放置在一起，也可以仅放置 frc 文件。U 盘强制升级 frc 程序的启动方式同主程序的升级方式：**不停的按遥控主页键的同时给电视机交流上电**，系统检测到升级文件之后会开启升级过程，但 frc 在升级过程中可能出现

屏幕显示异常的现象, 整个升级过程大约 1 分钟左右, 系统升级完成之后会自动进入待机状态。相关过程的 Log 如下:

B、使用串口工具开启升级:

将 frc 程序数据文件放置在 U 盘根目录 (注意不需要放置在 TargetHis 目录), 电视机连接串口工具之后, 分别按照如下的指令进行操作即可开启 FRC 升级过程, 升级过程大约耗时 1 分钟左右, 升级完成之后, 请手动进行电视机的交流开关机。

Edison #cu

4、如何升级 9679 芯片的程序:

使用 U 盘强制升级方式: 将 9679 升级文件更改成 9679.bin 文件放置在 TargetHis 文件目录下, 注意此时可以和主程序相关配置文件放置在一起, 也可以仅放置 9679 文件。进工厂后在工厂选项里有 9679 的升级菜单, 点击即可自动升级, 升级完需要重启才能有效

补充:

● Mstar 系列如何查看系统信息:

在图像--对比度下按数字键【6-0-0-6】, 会出现以下系统信息:

系统信息			
硬件信息	模组信息 Module Information	分辨率 Resolution	1920×1080
		屏类型 Panel Type	A+ LED ECO
		色深 Color Depth	10bit+10bit+10bit
		可视角度 Viewing Angle	±178°
	机芯硬件 Chip&Hardware	架构 Core/Microarchitecture	Cortex ARM 7
		主频 CPU rate	四核1.0GHz
		内存/存储 Memory/Flash	DDRIII/4GB(32Gb)
		图形处理器 GPU	Mali450双核GPU
能效特性	底层系统 Basic System	Hi-SMART	
	操控界面 User Interface	Hisense Vision 3.0	
软件功能	无线网络模块 Wifi Module	2.4GHz wifi	
	节能技术 Energy-Saving Technology	3E-ECO	
	图像处理	● 3D降噪 ● LED晶影引擎	
	音效软件	● dbx-tv语音降噪	
其它功能	特色功能	● 聚好看 ● 聚好玩 ● 聚好用 ● 聚好学 ● 聚享家	
	其它功能	● DTMB ● 媒体云	

图 3.15

D、升级之后的相关维护工作

软件升级完成后, 进入工厂菜单下执行清空母块操作并确定一下软件版本信息, 清母块主要针对的是清空用户数据, 。清母块需先进工厂, 方式如下:

进入工厂调试模式方法: 在伴音平衡下按下 1969, 进入工厂模式之后系统会显示 M 字样。

Vidaa 系列进入工厂调试模式方法: 除了和 vision 相同升级方法外还可在伴音平衡下按下红-绿-蓝-黄-红, 进入工厂模式之后系统会显示 M 字样。(mstar 的 vidaa 系列后面按此执行)

进入工厂后点击 工厂菜单-->母块清空即可

E、如何获取有效的 Log 信息

主要存在三种方法：

1、使用串口调试工具获取的方法：此方法可以实时查看 Log 信息或进行指令调试。连接时，注意端口根据实际串行工具检查的 com 口进行设置。

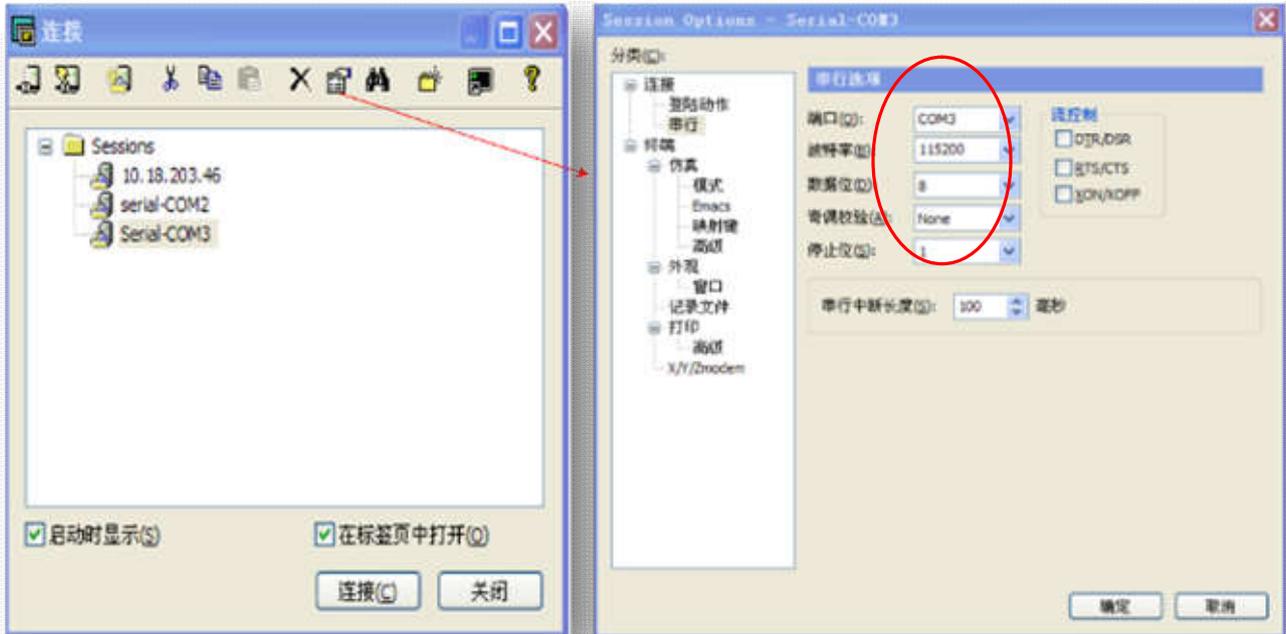


图 5-1 连接串口调试工具

注意波特率、数据位、停止位需要按上图填写，不能改变。

Log 的保存：选择【文件】-->【会话日志】进行文件保存。在测试过程中有异常情况出现时，提交保存的 Log 信息，可以输入 `logcat -v time` 打出的信息更多更全一些。

2、拷贝到 U 盘里

在电视机任意 USB 口中插入 U 盘并按如下操作可更完整的保留 log 信息：

- a、在串口监控窗口中敲回车，此时系统将提示：`shell@android:/ $`
- b、输入 `su` 后回车系统提示：`shell@android:/ #`
- c、执行 `Mstar_bugreport.sh` 脚本，如果记不住该指令可以在输入 `Mstar_` 之后按下 `tab` 键，系统将自动搜索显示 `Mstar_bugreport.sh` 回车即可。
- d、上述指令执行之后，会在 u 盘中会自动生成一个 bug 文件夹。

3、Vidaa3 支持遥控按键获取 Log 的方法：在 TV 开机且插入 U 盘后，支持任何场景、任意界面下，只要连续输入遥控器底部 4 色按键序列【蓝-黄-黄-蓝-蓝】，即可抓取日志（包括 `logcat/procrank/traces` etc）到 U 盘根目录文件夹 `bugreports` 下。需要注意的是，由于是低优先级写入操作，所以耗时较长（8M 左右的文件，平均耗时 15 秒），建议工人执行后，默认等待 20 秒后拔下 U 盘，文件存放的目录为 `bugreports`。

F、故障板的常规判断方法

（逐渐更新中……）

通过软件方法判断故障现象之前，需要先了解软件加载和执行的顺序。电视在上电之后，首先是启动主 IC

中固化的 ROMCode, 通过 ROM CODE 初始化 SDRAM 并装载 Pre-Loader 进行执行, 之后顺序装载 Boot、Kernel 等程序模块。

6.1 如果没有任何的 Log 信息怎么办?

因为主控 IC 中是有一部分 ROM Code 的, 此时系统会打印一小部分 Log 信息。如果此时没有任何的 Log 输出, 首先判断 IC 是否有正常供电, 或外围晶体等是否工作正常, 确定上述硬件设施没有异常的情况下再进行软件性维修。硬件故障通常通过重焊 IC 等方式进行排查, 软件性维修主要包含:

- 1、升级对应的 BootLoader 程序
- 2、使用 U 盘方式升级主程序。

系统启动过程中正常 Log 信息如下:

```
>> mmc slc 0 1
--21 %
SLC mode or reliable write has been set, slc size is 0 bytes

>> mmc rmgpt
--22 %
no UBOOT Partition found!

>> mmc create misc 0x00080000
--23 %
Need write new driver description table!
Add new partition misc success!

>> mmc create recovery 0x00800000
--24 %
Add new partition recovery success!

>> mmc create boot 0x00400000
--25 %
Add new partition boot success!

>> mmc create system 0x40000000
--26 %
```

图 6-1

6.2 系统开启后出现不停的停止运行或者机器死在开机智能花, 确认有无 coredump 异常, 如有异常, 请拷贝下面第一行指定的目录下文件提供一下。拷贝完成注意执行 sync 再拔出 U 盘。

```
[ 77.032239] ***** Create coredump file to /data/core_dump.1179.gz *****^M
[ 77.039052] * Ultimate CoreDump v1.0 : started dumping core into 'Coredump.1600.gz' file *^M
[ 77.047946] 1##### elf aligned pages num : 5 + (3 Coredump guard buffers)^M
[ 77.055046] ##### Not used first lower guard page, elf_offset : 18188, aligned_elf_offset : 20480^M
[ 77.064464] ##### set_gzip_header() return success...^M
[ 77.069679] ##### Allocated 268104 bytes for deflate workspace^M
[ 77.075541] ##### coredump_alloc_workspaces() return success...^M
[ 78.125213] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 78.322922] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 78.673782] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 78.868910] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 79.195942] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 79.395614] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 79.593852] ##### default buf is full...cnt : 3^M
[ 79.793010] ##### default buf is full...cnt : 4^M
[ 79.993807] ##### default buf is full...cnt : 5^M
[ 80.191411] ##### default buf is full...cnt : 6^M
[ 80.399865] ##### default buf is full...cnt : 7^M
```

图 6.2

6.3 Android 重启

Android 重启即智能花重启，基本可以判定是软件故障，原因一般是内存泄露或空指针。

6.4 整机重启

整机重启指从 hisense logo 开始重启，最好先分析硬件问题，有可能是 DDR 或 eMMC 没有焊好，电源供电有问题，如果排除硬件故障，软件性故障分析起来比较麻烦，内存泄露、内存不足、空指针等都有可能，导致的原因较多，再补充。

6.5 黑屏（背光不亮）

硬件良测背光电源是否正常，若正常则才是软件故障，可能是时序错误导致背光被关掉了。

6.6 整机 LOG 查看方法与分析



开机打印分析.txt